

无锡红光微电子股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）

主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年七月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、挂牌公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）实际控制人不当控制的风险

王福泉、魏丽娟夫妇合计直接持有公司 99.00%的股权，对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，王福泉、魏丽娟夫妇均为公司董事，且王福泉为公司董事长、总经理，可对公司施加重大影响。若王福泉、魏丽娟夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

（二）公司内部控制的的风险

有限公司阶段及股份公司成立初期，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东（大）会审议的情形。

2013年9月9日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《货币资金管理办法》等内部制度等规章制度；2013年9月9日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；2014年4月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

（三）受半导体行业景气状况影响的风险

公司主要业务是半导体器件的封装与测试，位于芯片设计与应用的中间环节，与芯片设计及应用环节紧密相连。如果下游半导体器件应用行业或上游芯片设计行业受半导体行业景气状况出现较大波动，将势必对半导体器件封装与测试行业带来较大影响，公司发展也将会受到一定的影响。

（四）生产要素价格上涨所致的盈利能力下滑风险

半导体器件封装与测试行业属于典型的加工制造业，以及劳动密集型产业。原材料、生产设备、劳动力价格上涨均会对公司的盈利能力带来不利影响。

（五）公司大规模固定资产投资导致的资产负债率较高的风险

公司报告期内投资新建了二期厂房以进一步扩大生产。同时，公司的设备也在稳定的更新中。预计公司在未来一年仍然有大规模的固定资产投资活动。由于公司采取债权融资的方式进行大量固定资产投资，包括新建厂房和购买设备，导致公司负债率较高。公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日资产负债率分别为 70.81%、72.27%。总体来说，公司资产期限与负债期限不配比，流动比率，速动比率偏低，有一定的偿债风险。

（六）公司对非经常性损益存在较大引起的利润波动风险

公司 2012 年度、2013 年度净利润分别为 249.67 万元、126.58 万元，扣非后的净利润分别为 161.22 万元、-9.66 万元，非经常性损益占同期净利润的比例分别为 107.63%、35.43%，公司对非经常性损益存在较大依赖。如公司未来非经常性利润不能持续，将对公司利润情况产生不利影响。

（七）担保风险

玉祁红光向中国银行股份有限公司无锡惠山支行、中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行分别贷款 500 万元，公司作为保证人分别向该两家银行为玉祁红光提供最高额为 500 万元的还款担保，担保到期日分别为 2016 年 7 月 4 日、2017 年 5 月 26 日。玉祁红光为公司控股股东王福泉控制的其它企业。

玉祁红光向中国银行股份有限公司惠山支行的 500 元贷款中，除红光微担保外，玉祁红光以自有土地使用权及地上厂房向中国银行股份有限公司惠山支行提供最高额为 600 万元的抵押担保，该土地及房产评估价值总计为 977.88 万元。

上述担保的债务中，虽然有一项债务有玉祁红光土地及厂房同时作抵押担保。但如果债务偿还期限届满时，玉祁红光发生财务危机不能还款，公司将应当按照担保合同承担保证责任，公司生产经营将遭受一定的不利影响。

（八）流动性不足、负债率过高风险

2012 年年底、2013 年年底，公司资产负债率均在 70%以上，且流动比率低于 1，截止 2013 年 12 月 31 日，短期借款余额 2800 万元。此外，公司还为控股股东控制的玉祁红光借款共计 1000 万元提供担保，虽然其中的 500 万元有玉祁红光土地及厂房同时作抵押担保，但仍有 500 万元未有其他形式担保，或反担保。公司存在负债率过高所致的偿

债风险、流动性不足风险。

二、潜在同业竞争及处理

控股股东王福泉除控股公司外,还持有玉祁红光 100.00%股权。玉祁红光成立于 1997 年 5 月 19 日,注册资本为人民币 800.00 万元。玉祁红光主营业务与公司较为相似,均从事半导体器件,包括半导体分立器件、集成电路的封装、测试。但玉祁红光产品细分领域与公司不同。公司产品主要是贴片式半导体器件、集成电路,产品具有薄、小、微型化、集成度高、低电功率的特点,主要应用于消费类电子产品,包括手机、彩电、MP3、笔记本电脑等领域;玉祁红光产品则主要是大型半导体器件,具有体积大、大功率、大电流的特点,主要应用于大电功率设备,如节能灯、充电器等设备。玉祁红光产品与公司产品在生产设备使用、工艺流程上亦不相同。

2014 年 4 月 30 日,江苏省半导体协议出具《证明》,认为公司产品与玉祁红光产品无论是产品用途、生产设备使用,还是生产工艺,均不相同,二者不具有相互替代性,玉祁红光与公司在生产经营上不构成业务竞争关系。

玉祁红光处于较为严重亏损的状态。玉祁红光资产缩水的主要原因是按照新会计准则,需计提大量应收账款减值损失。为避免玉祁红光拖累红光微经营,玉祁红光暂不并入红光微。但为避免出现潜在同业竞争,2014 年 4 月 29 日玉祁红光及其股东王福泉作出如下承诺:

1、玉祁红光将专注于大型半导体器件的封装、测试及销售,不从事红光微所从事的小微型半导体器件封装、测试、销售业务。玉祁红光违反本承诺所获取的全部收益归红光微所有。为督促玉祁红光履行本承诺,红光微在股转系统挂牌后玉祁红光并入红光微前,玉祁红光将每年接受有关主营业务的专项审计,核查玉祁红光是否违反本承诺,并将审计报告交送红光微,由红光微连同拟披露的红光微年报一并在股转系统公司指定的平台披露。审计机构为红光微指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所,审计费用由红光微承担。

2、给予玉祁红光两年左右的催收账款时间。待玉祁红光经营状况好转,应收账款催收结果确定,玉祁红光将并入红光微,并入方式为红光微向王福泉全资收购玉祁红光 100%股权,收购后,玉祁红光成为红光微全资子公司。2016 年下半年,王福泉将玉祁红光全部股权按玉祁红光以 2016 年 6 月 30 日为基准日经评估的净资产值转让给红光微,即王福泉按 1 元评估净资产作价 1 元的价格向红光微转让玉祁红光全部股权。相关审计、评估机构为具有证券期货从业资格的会计师事务所、资产评估公司,具体由红光微指定,

并由红光微承担审计、评估费用。

目录

目录.....	6
释义.....	8
第一节基本情况.....	11
一、公司基本情况.....	11
二、挂牌股份的基本情况.....	11
三、公司股权基本情况.....	13
四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况.....	14
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	18
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	20
七、本次挂牌的有关机构.....	20
第二节公司业务.....	23
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	23
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	24
三、公司业务相关的关键资源要素.....	25
四、公司业务具体状况.....	35
五、公司的商业模式.....	40
六、所处行业基本情况.....	41
第三节公司治理.....	45
一、近两年公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	45
二、公司董事会对公司现有治理机制建设及运行情况的评估结果.....	45
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	46
四、公司独立性情况.....	47
五、同业竞争情况.....	48
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	50
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第四节公司财务.....	55
一、最近两年的审计意见.....	55
二、最近两年的主要财务报表.....	55
三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响.....	62
四、最近两年的主要会计数据和财务指标.....	71
五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	92
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	97
七、报告期内公司资产评估情况.....	98

八、最近两年股利分配政策和分配情况.....	99
九、管理层对公司风险因素自我评估.....	99
第五节有关声明.....	103
一、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	103
二、主办券商声明.....	104
三、律师事务所声明.....	105
四、会计师事务所声明.....	106
五、资产评估机构声明.....	107
第六节附件.....	108
一、主办券商推荐报告.....	108
二、财务报表及审计报告.....	108
三、法律意见书.....	108
四、公司章程.....	108
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及证监会核准文件.....	108

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、红光微	指	无锡红光微电子股份有限公司
有限公司	指	无锡红光微电子有限公司
玉祁红光	指	无锡市玉祁红光电子有限公司
蓝箭电子	指	无锡市蓝箭电子器材厂
鸿昕电子	指	锦州市鸿昕电子有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《无锡红光微电子股份有限公司章程》

三会	指	有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》
TO	指	Transistor Out-Line, 晶体管外形封装
SOT	指	Small Out-Line Transistor, 小外形晶体管封装
SOP	指	Small Out-Line Package 小外形外壳封装
QFN	指	Quad Flat No-leadPackage, 方形扁平无引脚封装
μm	指	微米，长度单位
焊盘	指	焊盘(land or pad)，表面贴装装配的基本构成单元，用来构成电路板的焊盘图案(land pattern)，即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合
压焊	指	利用焊接时施加一定压力而完成焊接的方法，压力焊又称压焊。锻焊、接触焊、摩擦焊、气压焊、冷压焊、爆炸焊属于压焊范畴。
飞思卡尔	指	飞思卡尔公司(Freescale™ Semiconductor)，原摩托罗拉半导体部，是全球领先的半导体公司，为规模庞大、增长迅速的市场提供嵌入式处理产品和连接产品
英特尔	指	英特尔公司，是全球最大的半导体芯片制造商，它成立于1968年，具有46年产品创新和市场领导的历史
飞索	指	飞索半导体公司，是全球最大的专门从事闪存开发、生产和营销的高科技跨国企业之一，于2003年由AMD和富士通整合各自的闪存业务合并成立，2005年12月完成分拆并在纳斯达克成功上市，目前在世界各地员工总数约有8500人
松下	指	松下公司，是一个跨国性公司，在全世界设有230多家公

		司，员工总数超过 290,493 人
富士通	指	富士通株式会社 (Fujitsu Kabushiki-gaisha)，是一家起源于日本的全球性信息通信技术 (ICT) 企业，提供着全方位的技术产品、解决方案和服务，总部位于东京
意法半导体	指	意法半导体 (ST) 集团，于 1987 年 6 月成立，是由意大利的 SGS 微电子公司和法国 Thomson 半导体公司合并而成，是世界最大的半导体公司之一
瑞萨	指	瑞萨科技公司，是世界十大半导体芯片供应商之一，在很多诸如移动通信、汽车电子和 PC/AV 等领域占用较高市场份额
英飞凌	指	英飞凌科技公司，于 1999 年 4 月 1 日在德国慕尼黑正式成立，是全球领先的半导体公司之一，其前身是西门子集团的半导体部门，于 1999 年独立，2000 年上市
KEC	指	韩国 KEC 半导体有限公司，中文名为“开益禧”，是一家专业制造二三极管和其它集成电路的跨国集团公司，最初成立于 1969 年 9 月，并于 1979 年完成上市，在中国有：无锡开益禧半导体有限公司 (KEC-W)、无锡泰石精密电子有限公司 (TSP)、开益禧无锡有限公司、开益禧中山有限 (KEC-Z) 公司，另有开益禧泰国公司，并在全球众多国家设有销售公司。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司基本情况

中文名称：无锡红光微电子股份有限公司

法定代表人：王福泉

有限公司设立日期：2001年12月10日

股份公司设立日期：2013年10月8日

注册资本：3218万元

住所：无锡市新区新洲路科技产业园93号B区-1地块

邮编：214028

信息披露负责人：陶光亮

互联网网址：<http://www.wxhgm.com>

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C41其他制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“3824电力电子元器件制造”。

主要业务：半导体器件，包括分立器件、集成电路的封装、测试

组织机构代码：73330252-4

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币1.00元
股票数量	32,180,000股
挂牌日期	

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、《公司章程》对股东所持股份的限制性规定

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

3、股东所持股份的限售安排

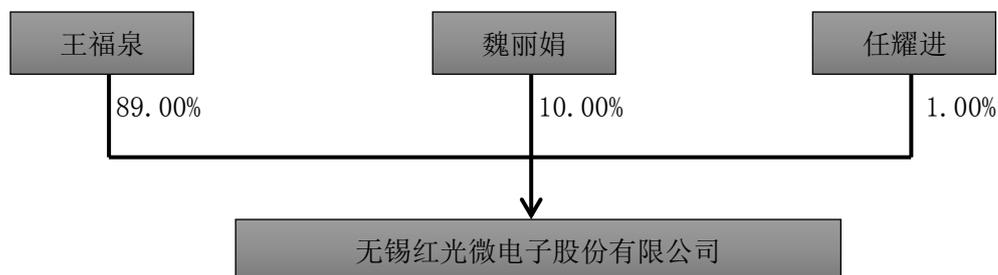
股份公司成立于 2013 年 10 月 8 日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司发起人持股未满一年。因此，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司股东无可进行公开转让的股份。

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

(一) 公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人的认定

王福泉持有公司 89.00%的股权，为公司的控股股东。

王福泉、魏丽娟系夫妻关系，二人合计持有公司 99.00%股权，为公司的实际控制人。

(三) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	持股方式
1	王福泉	28,640,200	89.00	境内自然人	直接持有
2	魏丽娟	3,218,000	10.00	境内自然人	直接持有
3	任耀进	321,800	1.00	境内自然人	直接持有
合计		32,180,000	100.00	——	——

(四) 公司股东直接或间接持有的公司股份质押或其他争议事项情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。

(五) 公司股东相互间的关联关系

王福泉与魏丽娟系夫妻关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

(六) 公司控股股东和实际控制人基本情况

1、王福泉，男，1964年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月毕业于无锡市玉祁高级中学，获高中学历；2009年7月毕业于清华大学MBA专业，获硕士学位。1983年8月至1990年12月任无锡玉祁晶体管厂项目经理；1991年1月至1997年4月任无锡市玉祁电讯电子器材厂长；1997年5月至2014年4月任玉祁红光执行董事、总经理；2014年4月至今任玉祁红光执行董事；2001年12月至2013年9月任有限公司执行董事、总经理；2013年9月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

2、魏丽娟，女，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月

毕业于无锡市广播电视大学工商管理专业，获大专学历。1996年8月至1997年4月待业；1997年5月至今任玉祁红光办公室主任；2002年1月至2013年9月任有限公司办公室副主任；2006年3月至今任蓝箭电子总经理；2014年4月至今任玉祁红光总经理；2013年9月至今任股份公司董事、办公室副主任，其中董事任期三年。

（七）最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东均为王福泉，实际控制人均为王福泉、魏丽娟夫妇。

四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、有限公司成立

无锡红光微电子股份有限公司前身为无锡红光微电子有限公司，于2001年12月10日经无锡工商行政管理局新区分局依法登记设立。有限公司注册资本为300.00万元。其中，王福泉认缴出资210.00万元；王伯权认缴出资90.00万元。王伯权、王福泉系父子关系，王伯权为王福泉父亲。

2001年11月29日，江苏公证会计师事务所出具苏公W[2001]B182号《验资报告》，验证截至2001年11月28日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元整，各股东均以货币出资。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王福泉	210.00	70.00	货币
2	王伯权	90.00	30.00	货币
合计		300.00	100.00	——

2、有限公司第一次增资

2002年11月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本增加至1118.00万元，新增注册资本818.00万元由原股东及新增股东以货币形式认缴。

本次增资情况具体如下表：

序号	增资人	增资总额（万元）	认缴出资额（万元）	增资价格（元/出资）	增资方式
1	王福泉	432.85	432.85	1.00	货币
2	杨朝晖	223.60	223.60	1.00	货币

3	王伯权	133.60	133.60	1.00	货币
4	陈建荣	16.77	16.77	1.00	货币
5	任耀进	11.18	11.18	1.00	货币
合计		818.00	818.00	—	—

2002年12月19日，无锡普信会计师事务所有限公司出具锡普财内验(2002)1097号《验资报告》，验证截至2002年12月19日止，公司已收到王福泉等5位股东缴纳的新增注册资本合计人民币818.00万元，均以货币出资。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王福泉	642.85	57.50	货币
2	杨朝晖	223.60	20.00	货币
3	王伯权	223.60	20.00	货币
4	陈建荣	16.77	1.50	货币
5	任耀进	11.18	1.00	货币
合计		1,118.00	100.00	—

3、有限公司第一次股权转让

2010年10月6日，王福泉、陈建荣签署《股权转让协议》，约定陈建荣将其持有的公司16.77万元出资额作价31.02万元转让给王福泉。

2010年10月6日，有限公司召开全体股东会，全体股东一致同意上述股权转让。

本次股权转让情况具体如下表：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让总价款(万元)	转让价格(元/出资)
1	陈建荣	王福泉	16.77	31.02	1.85
合计			16.77	31.02	—

本次股权转让后，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王福泉	659.62	59.00	货币
2	杨朝晖	223.60	20.00	货币
3	王伯权	223.60	20.00	货币
4	任耀进	11.18	1.00	货币
合计		1,118.00	100.00	—

4、有限公司第二次股权转让

2011年1月10日，公司召开临时股东会，全体股东一致同意杨朝晖、王伯权将其各自持有的公司223.60万元出资额分别转让给王福泉。

2011年1月10日，王福泉、杨朝晖签署《股权转让协议》，约定杨朝晖将其持有的公司223.60万元出资额作价585.60万元转让给王福泉。本次股权转让价格参考当时公司账面净资产。

2011年1月12日，王福泉、王伯权签署《股权转让协议》，约定王伯权将其持有的公司223.60万元出资额作价223.60万元转让给王福泉。王伯权系王福泉父亲，本次股权转让价格低于相应出资额对应的账面净资产，每1元出资额作价1元。

本次股权转让情况具体如下表：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让总价款（万元）	转让价格（元/出资）
1	王伯权	王福泉	223.60	223.60	1.00
2	杨朝晖		223.60	585.60	2.62
合计			447.20	809.20	——

本次股权转让后，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王福泉	1,106.82	99.00	货币
2	任耀进	11.18	1.00	货币
合计		1,118.00	100.00	——

5、有限公司第二次增资

2011年5月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本增加至2218.00万元，新增注册资本由原股东王福泉认缴867.20万元，任耀进认缴11.00万元，新股东魏丽娟认缴221.80万元。

本次增资情况具体如下表：

序号	增资人	增资总额（万元）	认缴出资额（万元）	增资价格（元/出资）	增资方式
1	王福泉	867.20	867.20	1.00	货币
2	魏丽娟	221.80	221.80	1.00	货币
3	任耀进	11.00	11.00	1.00	货币
合计		1,100.00	1,100.00	——	——

2011年5月17日，无锡瑞华会计师事务所有限公司出具锡瑞会内验A（2011）第478号《验资报告》，验证截至2011年5月16日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币1100.00万元，各股东均以货币出资。

至此，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王福泉	1,974.02	89.00	货币
2	魏丽娟	221.80	10.00	货币
4	任耀进	22.18	1.00	货币
合计		2,218.00	100.00	——

6、有限公司整体变更为股份公司

2013年8月15日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意作为发起人,以2013年5月31日为基准日,以有限公司经中瑞岳华会计师事务所审计的账面净资产值38,044,953.14元(中瑞岳华专审字[2013]第2776号《审计报告》)按1:0.85比例折合为股份3,218.00万股(每股面值1.00元),整体变更为股份公司,股份公司注册资本为3,218.00万元,净资产扣除股本后的余额5,864,953.14元计入资本公积。

2013年7月18日,经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2013)第338号《无锡红光微电子有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告书》,有限公司在评估基准日2013年5月31日经评估的净资产值为6,124.50万元。

2013年9月9日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2013]第91180002号),验证截至2013年9月9日止,公司全体发起人已按发起人协议、章程之规定,以其拥有的原有限公司2013年5月31日经审计净资产人民币38,044,953.14元为基准,按1:0.8458的比例折为公司的股份32,180,000股,按每股面值1元计,其中股本为人民币32,180,000.00元,余额人民币5,864,953.14元作为资本公积。

2013年9月9日,股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。

2013年10月8日,江苏省无锡工商行政管理局对股份公司核发了《企业法人营业执照》,注册号为320213000029176。

至此,股份公司股权结构如下:

序号	股东	持股数额(股)	持股比例(%)	出资方式
1	王福泉	28,640,200	89.00	净资产
2	魏丽娟	3,218,000	10.00	净资产
3	任耀进	321,800	1.00	净资产
合计		32,180,000	100.00	——

(二) 公司设立以来重大资产重组情况

公司设立至今未发生重大资产重组情况。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事

1、王福泉，股份公司董事长，任期三年，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（六）公司控股股东和实际控制人基本情况”。

2、魏丽娟，股份公司董事，任期三年，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（六）公司控股股东和实际控制人基本情况”。

3、任耀进，男，1958年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年7月毕业于无锡市玉祁中学，获高中学历；1998年7月毕业于无锡市广播电视大学工商管理专业，获大专学历。1976年8月至1992年12月先后任无锡市玉祁蓉新电讯电器设备厂生产线职员、供应科科长、销售科科长；1993年1月至1997年4月任无锡玉祁电讯电子器材厂副厂长；1997年4月至2002年12月任玉祁红光副总经理；2003年1月至2013年9月任有限公司副总经理；2013年9月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

4、蔡振华，男，1951年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1967年7月毕业于无锡市解放中学，获初中学历；1983年3月毕业于国营第742工厂（国营江南无线电器材厂）职工大学半导体器件专业获大专学历。1967年8月至1968年9月待业；1968年10月至1970年12月于江苏省东台县新街公社知青插队；1970年12月至1974年12月任地方国营东台磷肥厂自动化仪表维修技术员；1974年12月至2004年8月任国营第742工厂（国营江南无线电器材厂）工程师；2004年8月至2007年5月任江阴新顺微电子有限公司销售经理；2007年5月至今任玉祁红光副总经理；2013年9月至今任股份公司董事，任期三年。

5、陶光亮，男，1962年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月毕业于扬州技工学校电子专业，获中专学历；1989年10月毕业于扬州市职工大学微机专业，获大专学历。1982年8月至1998年7月任中美合资扬州晶来电子有限公司（晶来集团成员企业）技术人员；1998年7月至1999年8月任中美合资扬州晶来电子有限公司总裁助理；1999年8月至2001年5月任扬州晶来集团副总经理、中美合资扬州晶来电子有限公司副总裁；2001年5月至2002年9月任中日合资扬州晶新微电子有限公司（晶来集团成员企业）副总经理；2002年9月至2003年10月任扬州晶来集团总经理、中美合资扬州晶来电子有限公司总裁；2003年10月至2004年10月任扬州晶来集团董事长、总经理；中美合资扬州晶来电子有限公司董事长、总经理；2004年11月至2008年5月任任扬州四通电光源有限公司（晶来集团成员企业）质量管理人员；2008年5月至2013年9月任有限公司副总经理；2013年9月至今任

股份公司董事、副总经理，任期三年。

（二）公司监事

1、陈璐，女，1968年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月毕业于江南大学商业经济管理专业，获大专学历。1989年7月至2003年5月，先后任无锡市家具二厂统计专员、出纳、主办会计、财务科长；2003年6月至2013年9月任有限公司财务主管；2013年9月至今任股份公司监事会主席、财务主管，其中监事会主席任期三年。

2、唐良，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年7月毕业于无锡市玉祁中学，获高中学历。1997年7月至2002年6月任无锡神速汽车电器有限公司操作工；2002年7月至2003年6月任玉祁红光操作工；2003年7月至2013年9月任有限公司仓库管理员；2013年9月至今任股份公司监事、仓库管理员，其中监事任期三年。

3、许小弟，男，1969年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年7月毕业于常州市武进潘家高级中学，获高中学历。1987年7月至1992年8月待业；1992年9月至1994年8月任常州市武进县潘家汽车修配厂修理工；1994年9月至1997年8月任常州东亚经贸有限公司驾驶员；1997年9月至2001年12月任玉祁红光驾驶员；2002年1月至2013年9月任有限公司驾驶员；2013年9月至今任股份公司职工监事、驾驶员，其中职工监事任期三年。

（三）公司高级管理人员

1、王福泉，股份公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”。

2、任耀进，股份公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

3、陶光亮，股份公司董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

4、任泉明，男，1947年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1967年7月毕业于无锡市玉祁中学，获高中学历；1987年12月毕业于江苏广播电视大学工业会计专业，获大专学历。1967年8月至1977年12月先后任无锡县玉祁公社蓉新大队生产队会计、大队助理会计；1978年1月至1980年12月任无锡县玉祁公社蓉新综合农机厂主办会计；1981年1月至1995年4月任无锡县玉祁多种经营服务公司财务科长；1995年5月至2003年3月任锡山市玉祁镇工业总公司经营管理办公室企业财务审计组长、镇物价员；2003年4月至2013年

9月任有限公司财务总监；2013年9月至今任股份公司财务总监，任期三年。

六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013. 12. 31	2012. 12. 31
资产总计（万元）	14,834.03	13,806.80
负债总计（万元）	10,778.00	9,776.43
股东权益合计（万元）	4,056.03	4,030.37
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	4,056.03	4,030.37
每股净资产（元）	1.26	1.82
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.26	1.82
资产负债率	72.66%	70.81%
流动比率（倍）	0.69	0.63
速动比率（倍）	0.53	0.48
项目	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	12,566.61	12,977.59
净利润（万元）	126.58	249.67
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	126.58	249.67
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-9.66	161.22
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-9.66	161.22
毛利率（%）	15.64	14.09
净资产收益率（%）	3.24	6.17
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.25	3.99
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08
应收账款周转率（次）	3.44	3.02
存货周转率（次）	6.76	7.10
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,482.31	1,419.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77	0.64

注：公司2012年为有限责任公司，2012年每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标中“股本数”均按公司股改后注册资本作为股本模拟计算。

七、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：杨慧佳

项目小组成员：林义明、尤家佳

（二）律师事务所

名称：北京大成（上海）律师事务所

法定代表人：邹志强

住所：上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层

联系电话：021-58785888

传真：021-20283853

经办律师：王恩顺、王越、邓炜

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：杨剑涛，顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办注册会计师：涂新春，赵现波

（四）资产评估机构

名称：北京中同华资产评估有限公司

法定代表人：季珉

住所：北京市西城区金融大街 35 号 819 室

联系电话：010-68090088

传真：010-68090099

经办注册资产评估师：徐建福、张麟

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

负责人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

负责人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

第二节 公司业务

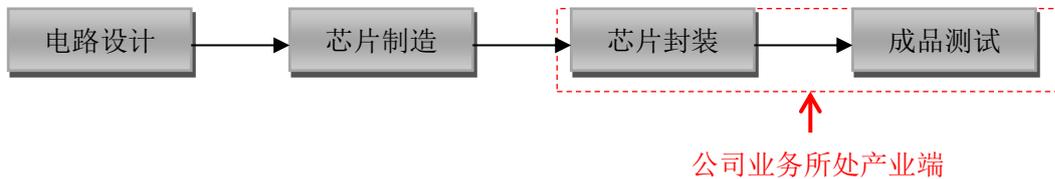
一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务

公司主要从事半导体器件（包括半导体分立器件、集成电路）的封装、测试。

半导体器件包括半导体分立器件、集成电路。半导体器件制造业因为其技术的复杂性目前分化为半导体器件的设计、芯片制造、半导体器件封装以及测试四个相对独立的行业。公司主要从事半导体器件制造的后端行业，即半导体器件的封装、测试。

半导体器件制造产业流程图

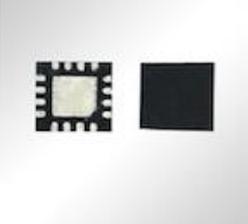


（二）主要产品或服务及用途

半导体芯片（包括分立器件芯片、集成电路芯片）是一种对使用环境具有高标准要求的产品，不能长时间裸露在外界，与空气接触。空气中的杂质和不良气体，乃至水蒸气都会腐蚀半导体芯片上的精密电路，进而造成电学性能下降。为防止外界对芯片的损害，就必须用特定工艺将半导体芯片包裹起来。半导体器件封装就是用特定材料、工艺技术对半导体芯片进行安放、固定、密封，保护芯片性能，并将芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，实现芯片内部功能的外部延伸。半导体芯片封装完成后，必须进行性能测试，保证封装的半导体器件符合工艺要求。

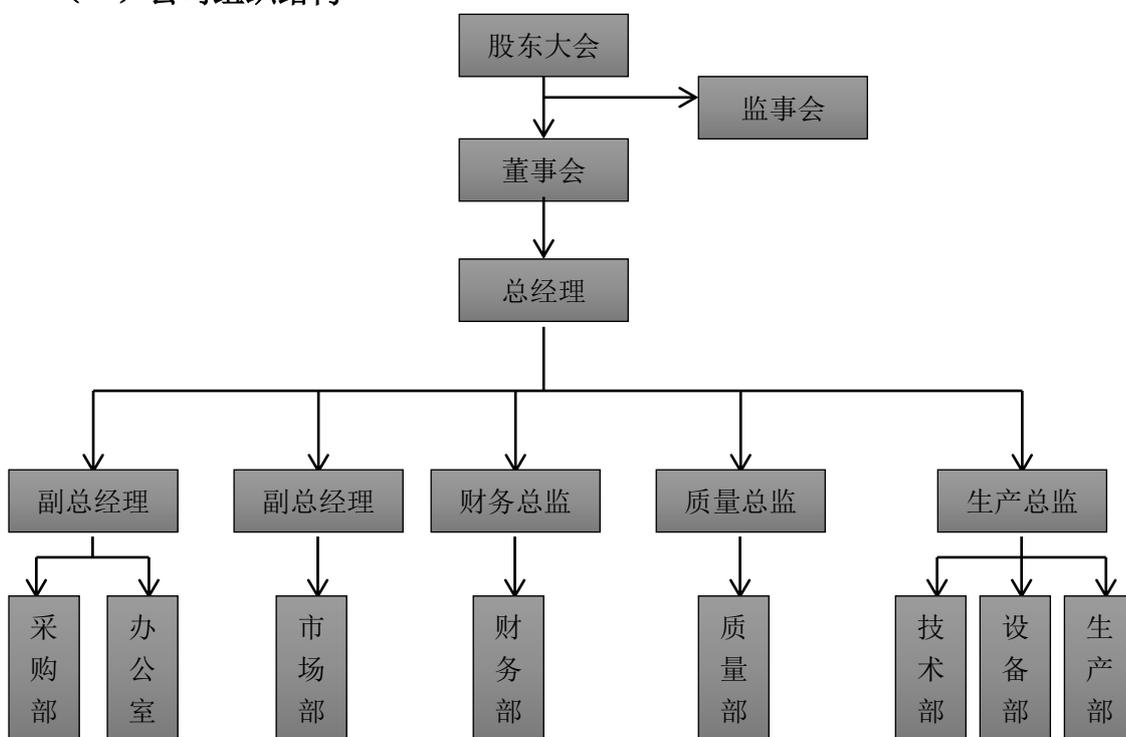
半导体器件主要运用于各类电子产品，根据产品的用途，必须采用不同的封装形式。根据封装形式，公司封装的系列产品及应用领域如下：

序号	封装形式（系列）	应用领域	产品样图
1	T0（含 T0-92、T0-220、T0-252 等型号）	遥控器、卫星接收、门铃、程控交换、发射模块、低噪声放大器、发射接收器	

2	SOT	电源管理、光电耦合和电子开关	
3	SOP	音响电路、DVD 电路、电话机电路、电源管理、音频处理器和遥控玩具	
4	QFN	LED/VFD 驱动电路、存储器、MP3 相关多媒体产品	

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

(一) 公司组织结构



(二) 主要生产、服务流程及方式

公司主要生产、服务流程及方式如下：

1、设备采购及日常维护

设备部与总经理负责公司生产设备的采购，并由设备部负责生产设备的日常维修、维护。

2、技术研发

质量部与技术部共同负责新产品、新技术的研发，具体包括：根据具体订单进行的产品研发，以及根据市场趋势进行的技术前瞻性研发。

3、市场开发、销售

市场部是公司负责市场开发、销售的专职部门。具体工作包括产品宣传、合同洽谈及签订、订单取得。

4、发出生产通知

市场部取得订单后，向销售部发出加工通知单，包括需求量、型号、工艺标准等。

5、原材料采购

生产部根据生产计划排原材料采购计划，并发送给采购部，采购部根据该计划执行原材料采购。

6、封装、测试

生产部是公司的产品生产部门，具体执行半导体器件的封装及测试。整个生产工艺流程包括：磨片、划片、装片、键合、包封、电镀、切金、去飞边、打标、测试、包装。

7、质量管理

质量部负责公司产品质量控制。产品质量控制贯穿公司产品生产的全流程，但是产品质量检验的重点主要在装片、键合、包封、测试等生产流程段。

8、产品入库

产品封装、测试完毕后，即予以入库。

9、产品出库、发货

市场部根据销售情况向仓库发出发货通知，仓库根据市场部通知向客户发货。

10、开票、收款

公司财务部根据市场部通知向客户开具销售发票。市场部负责与客户对账，并完成收款。

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司产品或服务所使用的主要技术

1、大直径晶圆减薄技术

芯片薄可增大热循环的可靠性, 并支持薄形产品。但薄的芯片易产生损伤, 引起微裂纹, 甚至碎裂。公司通过技术攻关, 在原有减薄技术上将最大为 12 英寸晶圆厚度减至 $150 \pm 10 \mu\text{m}$, 晶圆平整度达到 $10 \mu\text{m}$ 以下。

2、大尺寸芯片粘片技术

芯片尺寸越大, 粘片技术难度越高, 本技术针对面积在 25mm^2 以上的芯片, 保证芯片粘接牢固、平整及导电性能, 粘片固化后, 其推力 $\geq 5.0 \text{ kg}$ 。

3、低弧度长引线高密度金丝球焊技术

由于芯片焊点多、引线密度高, 焊线时需确定线弧形状, 同时将弧高控制在 $100 \sim 150 \mu\text{m}$ 之间, 本技术可有效防止出现低弧线压塌、短路、划伤现象。

4、薄形大面积塑料包封技术

TSSOP 型塑料封装的厚度仅为 1.00 mm , 除去芯片、引线框架的厚度、金丝弧高后, 包封层单面厚度不足 0.5 mm , 它必须满足高压蒸煮、温度冲击等各项可靠性要求。同时, 还必须解决塑封体共面性与应力变形问题。

5、外引线无铅电镀技术

采用先进的镀纯锡工艺, 淘汰传统的锡铅电镀工艺, 彻底消除了铅对人体和环境的污染。

6、切筋成形和外引线共面性技术

严格切筋成形工艺, 采用新的高压水去毛刺工艺, 防止手工去毛刺时引线变形, 借助共面性检测仪对切筋成形系统的质量状况进行监控, 使共面性达到 $100 \mu\text{m}$ 以内。

7、第二次精确装片技术

针对集成电路叠层封装开发的上层芯片精确装片技术。对于叠层封装来说, 第二层芯片上的焊盘 (PAD) 不仅要与框架内的引脚间连线, 而且还要与一部分下层芯片上的 PAD 连线, 上层芯片装片位置如果不精确, 压焊时会形成交丝现象, 造成产品报废。第二次精确装片技术可有效解决该技术难题。

8、多层芯片长引线低弧度压焊/塑封技术

针对 PQFP100L 叠层封装开发的技术。在 PQFP100L 叠层封装中, 下层芯片 $7\text{mm} \times 14\text{mm}$, 上层芯片 $4.2\text{mm} \times 4.0\text{mm}$, 上层芯片 PAD 到引线框架的部分焊线长 9mm (常见最长为 5mm), 要求弧度控制在 $300 \mu\text{m}$ 以下, 多层芯片长引线低弧度压焊/塑封技术可解决该技术难题。

9、绿色环保封装技术

绿色环保封装技术指为实现绿色环保封装产品而采用的封装材料、工艺技术, 可使得器件

封装内部的有害物质含量和装备流程符合环保要求。

(二) 公司的无形资产

1、专利权

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	保护期限	最近一期末账面价值(元)	实际实用情况
1	一种改进型手动激光打印夹具	200920036271.7	红光微	实用新型	2009.03.09 — 2019.03.08	0	正在使用,主要用于公司产品打标工序
2	一种多芯片双基岛的SOT封装结构	200920036272.1	红光微	实用新型	2009.03.09 — 2019.03.08	0	正在使用,用于公司SOT产品封装框架结构
3	一种改进型的SOT封装结构	200920036274.0	红光微	实用新型	2009.03.09 — 2019.03.08	0	正在使用,用于公司SOT产品封装框架结构
4	一种to220封装器件分选机的轨道结构	200920040455.0	红光微	实用新型	2009.04.23 — 2019.04.22	0	正在使用,用于产品分选机轨道装置
5	一种sot23/26封装器件编带的补带装置	200920045877.7	红光微	实用新型	2009.05.14 — 2019.05.13	0	正在使用,用于封装器件的编带的补带
6	一种to220测试分选机的挡料机构	200920045876.2	红光微	实用新型	2009.05.14 — 2019.05.13	0	正在使用,用于测试分选机的进料、送料过程
7	一种USB接口的普洛菲斯触摸屏的数据线	201020004443.5	红光微	实用新型	2010.01.18 — 2020.01.17	0	正在使用,应于公司触控屏与封装设备连接的数据线
8	一种SOT26-3L封装的引线框架结构	201020004442.0	红光微	实用新型	2010.01.18 — 2020.01.17	0	正在使用,用于公司SOT产品封装引线框架结构

9	一种 T03P 防水密封引线框架	201120114906.8	红光微	实用新型	2011.04.19 — 2021.04.18	0	正在使用,用于公司 T0 产品封装引线框架结构
10	一种 USB 接口的三菱 FX2N 系列 PLC 数据通讯线	201120114914.2	红光微	实用新型	2011.04.19 — 2021.04.18	0	正在使用,用于公司设备连接数据线
11	一种 T0220B-5L 防水密封引线框架	201120114908.7	红光微	实用新型	2011.04.19 — 2021.04.18	0	正在使用,用于公司 T0 产品引线框架
12	一种 T0220B-7L 防水密封引线框架	201120114885.X	红光微	实用新型	2011.04.19 — 2021.04.18	0	正在使用,用于公司 T0 系列产品引线框架
13	一种 QFN 封装框架结构	201120285511.4	红光微	实用新型	2011.08.08 — 2021.08.07	0	正在使用,用于公司 QFN 系列产品引线框架
14	一种封装引线框架结构	201120417628.3	红光微	实用新型	2011.10.28 — 2021.10.27	0	正在使用,用于公司封装引线框架
15	一种 DIP 封装引线框架	201120417650.8	红光微	实用新型	2011.10.28 — 2021.10.27	0	正在使用,用于公司 DIP 系列产品封装引线框架
16	一种 QFN 封装工艺的塑封料上料架	201220135126.6	红光微	实用新型	2012.04.01 — 2022.03.31	0	正在使用,用于公司 QFN 系列产品封装的上料
17	一种 QFN 工艺的塑封成型产品的放料架	201220216606.5	红光微	实用新型	2012.05.15 — 2022.05.14	0	正在使用,用于公司 QFN 产品放料架
18	一种 T0-252 封装引线框架结构	201220350782.8	红光微	实用新型	2012.07.19 —	0	正在使用,用于公司 T0 系列产品引线框架

					2022.07.18		
19	一种 SOT223-3L 封装引线框 架	201220350772.4	红光微	实用 新型	2012.07.19 — 2022.07.18	0	正在使用,用于公 司 SOT 系列产品 引线框架
20	一种 SOT89-3L 封 装引线框架	201220382033.3	红光微	实用 新型	2012.08.03 — 2022.08.02	0	正在使用,用于公 司 SOT 系列产品 引线框架
21	一种 SOT89-5L 封 装引线框架	201220382002.8	红光微	实用 新型	2012.08.03 — 2022.08.02	0	正在使用,用于公 司 SOT 系列产品 引线框架
22	一种 SOT23/26 分 选机的进料 轨道	201220427384.1	红光微	实用 新型	2012.08.03 — 2022.08.02	0	正在使用,用于公 司 SOT 系列产品 分选机
23	一种半导体 封装模具的 型腔精准定 位块结构	201220427359.3	红光微	实用 新型	2012.08.27 — 2022.08.26	0	正在使用,用于公 司封装设备定位 装置
24	一种塑封自 动模注射头 结构	201220478570.8	红光微	实用 新型	2012.09.19 — 2022.09.18	0	正在使用,用于公 司封装设备装置
25	一种用于磨 片过程中测 量晶圆厚度 的测厚仪结 构	201220478618.5	红光微	实用 新型	2012.09.19 — 2022.09.18	0	正在使用,用于公 司测厚仪装置
26	一种 T0251/252 分选机进料 区保持块结 构	201220478809.1	红光微	实用 新型	2012.09.19 — 2022.09.18	0	正在使用,用于分 选机装置
27	一种震胶装 置结构	201220652825.8	红光微	实用 新型	2012.12.03 — 2022.12.02	0	正在使用,用于公 司封胶的摇震均 匀

28	一种 T0-252-3LB 引线框架结构	201220652950.9	红光微	实用新型	2012.12.03 — 2022.12.02	0	正在使用,用于公司 T0 系列产品的 引线框架
29	一种 SOT26-3LB 封装引线装置	201220652904.9	红光微	实用新型	2012.12.03 — 2022.12.02	0	正在使用,用于公司 SOT 系列产品的 引线框架
30	一种划膜机 结构	201220652815.4	红光微	实用新型	2012.12.03 — 2022.12.02	0	正在使用,用于公司 的划膜机装置
31	一种 SOP-8L 封装引线框架	201320413140.2	红光微	实用新型	2013.07.12 — 2023.07.11	0	正在使用,用于 SOP 系列产品封装 引线框架
32	一种改进型 to220 封装 器件分选机 的轨道结构	200910031581.4	红光微	发明专利	2009.04.23 — 2029.04.22	0	正在使用,用于 TO 分装器件分选 机中
33	一种改进型 sot23/26 封 装器件编带 的补带装置	200910027972.9	红光微	发明专利	2009.05.14 — 2029.05.13	0	正在使用,用于封 装器件编带装置
34	封装引线框 架结构	201110332730.8	红光微	发明专利	2011.10.28 — 2033.10.27	0	正在使用,用于封 装引线框架
35	双边扁平无 铅封装框架 (3x3)	201130451701.4	红光微	外观设计	2011.12.01 — 2021.11.30	0	正在使用,用于封 装引线框架
36	方形扁平无 引脚封装框 架(3x3)	201130451689.7	红光微	外观设计	2011.12.01 — 2021.11.30	0	正在使用,用于封 装引线框架
37	双边扁平无 铅封装框架 (3x2)	201130451704.8	红光微	外观设计	2011.12.01 —	0	正在使用,用于封 装引线框架

					2021.11.30		
38	集成电路板 (方形扁平 无引脚封装 框架 4x4)	201130451712.2	红光微	外观设计	2011.12.01 — 2021.11.30	0	正在使用,用于封装引线框架

注：上述专利技术均为原始取得。

2、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 1 项土地使用权，具体情况如下：

土地实用权人：	红光微
地号：	3202920012090013000
座落：	无锡新区开发区 93# -B-1 地块
类型（用途）：	工业用地
使用权类型：	出让
使用权终止日期：	2052 年 01 月 31 日
使用权面积：	25465.8 平方米
独用面积：	25465.8 平方米
分摊面积：	0 平方米
实际使用情况：	该地块为公司生产、办公所在地，建设有：一期厂房、二期厂房（在建）、动力房、综合楼
最近一期末账面价值（元）：	1,749,119.39
抵押情况：	1、根据《最高额抵押合同》编号：锡农商高抵字[2013]第 010501121302，该宗地设定抵押，红光微将该宗地块面积为 25465.8 平方米土地使用权抵押给无锡农村商业银行股份有限公司，其中土地银行确认金额为 1940.49 万元，抵押金额为 900 万元，权利顺序壹，抵押期限自 2013-12-13 至 2018-12-12 止 2、根据《最高额抵押合同》编号：锡农商高抵字[2014]第 010501030301，该宗地设定抵押，红光微将该宗地块面积为 25465.8 平方米土地使用权连同 7284.65 平方米地上房产一并抵押给无锡农村商业银行股份有限公司，其中土地银行确认金额为 1940.49 万元，抵押金额为 360 万元，权利顺序贰，抵押期限自 2014-03-03 至 2019-02-28 止

（三）取得的业务许可资格或资质情况

公司取得的各类主要资质证书有：

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	高新技术企业证书	GF201332000608	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2013.12.11	3 年
2	安全生产标准化证书	AQBIIIQT 苏 201304726	无锡市安全生产监督管理局	2013.10.13	3 年

3	清洁生产审核证书	---	无锡市清洁生产审核领导小组办公室	2012.2	---
4	无锡市企业技术中心认定证书	0332020012003	无锡市经济和信息化委员会	2012.3.20	---

(四) 公司重要固定资产、在建工程

截至本公开转让说明书签署日，公司主要生产设备等重要固定资产、在建工程情况如下：

序号	名称	数量	使用情况	成新率(%)
1	单面磨片机	1	使用中，为公司磨片工序使用设备	50.00
2	各式划片机	4	使用中，为公司划片工序使用设备	28.55
3	全自动银浆固晶机	12	使用中，为公司装片工序使用设备	44.66
4	焊线机	7	使用中，为公司键合工序使用设备	82.04
5	全自动金线焊接机	31	使用中，为公司键合工序使用设备	41.96
6	塑料封装压机	17	使用中，为公司包封工序使用设备	39.87
7	激光打标机	24	使用中，为公司打标工序使用设备	41.52
8	全自动测试系统	26	使用中，为公司测试工序使用设备	38.44
9	一期厂房（建筑面积4430.5平方米）	1	使用中，为公司厂房、仓库、办公楼所在地	58.27
10	动力房（建筑面积695.18平方米）	1	使用中，为公司发电机、变电设施所在地	58.27
11	综合楼（建筑面积2194.97平方米）	1	正在使用中，为公司食堂、员工宿舍所在地	83.00
12	二期厂房（建筑面积4484平方米）	1	正在装修中，为公司二期生产厂房所在地	---

注：上表第12项所列的二期厂房为公司在建工程。截至本公开转让说明书签署日，二期厂房已取得立项、环保、安全等部门批文，以及工程建筑规划许可证、建筑施工许可证。

截至本公开转让说明书签署时，二期厂房尚未办理房产证，关于办理房产证各项手续的进展如下：《建

建设工程规划许可证》(建字第 3202012011X0190 号)、《建筑工程施工许可证》(编号: 320291020110029)、《建设工程规划核实合格证》(核字第 3202012013X0156)均已办理完毕,消防验收已通过(编号为锡新公消设字【2014】第 0003 号<无锡市公安消防支队新区大队建设工程消防设计备案检查意见>),环保方面已进行雨、污水接管批准。前尚有装修消防验收、安全手续正在办理之中。其他如环保竣工验收以及土建验收备案尚未进行,因办理房产证必须环保、规划、安全、消防等所有手续办理完毕,经过竣工验收备案后方可进行。

(五) 公司员工情况

1、员工人数及结构

截至 2014 年 5 月 4 日,公司共有员工 318 人(含聘用退休人员 4 人,劳务派遣 6 人,实习生 12 人),其具体人数及结构如下:

(1) 按年龄划分

年龄段	人数	比例(%)
25 岁(含)以下	97	30.50
26—30(含)岁	80	25.16
31-40(含)岁	101	31.76
41(含)岁以上	30	9.43
合计	318	100.00

(2) 按专业结构划分

部门	人数	比例(%)
管理人员	19	5.97
技术研发人员	48	15.09
销售人员	2	0.63
财务人员	3	0.94
一线生产人员	246	77.36
合计	318	100.00

(3) 按教育程度划分

学历	人数	比例(%)
研究生	1	0.31
本科	15	4.72
大专	52	16.35
高中及以下	250	78.62
合计	318	100.00

2、公司核心技术人员简历情况

刘康，男，1962年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月毕业于成都电讯工程学院半导体器件专业，获本科学历。1983年8月至1992年2月任甘肃天光集成电路厂技术员、工程师；1992年2月至1996年8月任甘肃天光集成电路厂工程师、技术处副处长；1996年8月至2000年2月任甘肃天光集成电路厂科技质量部部长；2000年2月至2003年6月任有限公司二分厂厂长；2003年6月至2013年9月任有限公司生产总监；2013年9月至今任股份公司质量总监。

董育智，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年6月毕业于哈尔滨电工学院工业电气自动化专业，获本科学历。1992年7月至2003年5月任国营七七厂工程师；2003年6月至2013年9月任有限公司技术部部长；2013年9月至今任股份公司技术部部长。

刘晓清，男，1981年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月毕业于苏州大学应用电子专业，获大专学历；2008年7月毕业于河海大学公共事业管理专业，获本科学历。2008年7月至2009年8月任明基电子科技（苏州）有限公司线长、技术员；2003年9月至2013年9月任有限公司技术部部长；2013年9月至今任股份公司技术部部长。

3、核心技术人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员暂未直接持有公司股权。

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

四、公司业务具体状况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

报告期内，公司的业务收入全部来自半导体器件销售收入。

报告期内，公司各期主要产品的规模、销售收入情况如下：

营业收入	2013年度		2012年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	125,075,100.79	99.53	128,862,104.49	99.30
T0-92	14,712,218.92	11.71	21,116,036.94	16.28
T0-220	4,911,843.71	3.91	4,444,398.33	3.42
SOT	98,901,000.34	78.70	102,234,755.68	78.78
T0-252	4,301,481.50	3.42	953,202.60	0.73
SOP8	2,248,556.33	1.79	113,710.94	0.09
其他业务收入	591,000.00	0.47	913,834.03	0.70

合计	125,666,100.79	100.00	129,775,938.52	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(二) 公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司产品的主要消费群体包括通讯类产品制造商，如手机制造商、IT 程控交换机制造商等；资讯类产品制造商，如 STB（机顶盒）、电脑、MP3 制造商等；电器类产品制造商，如家用电器、电子玩具、电子钟表制造商等；工业自动化系统制造商，如自动控制装置、智能仪表制造商等；以及其他类对半导体分立器件、集成电路有需求的客户。

2、公司前五名客户情况

公司 2013 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	北京确安科技股份有限公司	19,971,121.57	15.89
2	上海贝岭股份有限公司	19,367,943.90	15.41
3	杭州尚格科技有限公司	18,097,740.08	14.40
4	苏州智浦芯联电子科技有限公司	5,634,820.58	4.48
5	吉林华微电子股份有限公司	3,996,335.27	3.18
2013 年度对前五大客户销售总额合计		67,067,961.40	53.37
2013 年度销售总额合计		125,666,100.79	100.00

公司 2012 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比（%）
1	上海贝岭股份有限公司	33,534,346.87	25.84
2	中国华大集成电路设计集团有限公司	13,370,574.44	10.30
3	南京智浦芯联电子科技有限公司	8,597,565.16	6.62
4	杭州尚格科技有限公司	7,342,631.97	5.66
5	北京确安科技股份有限公司	5,353,236.50	4.12
2012 年度对前五大客户销售总额合计		68,198,354.95	52.55
2012 年度销售总额合计		129,775,938.52	100.00

报告期内，公司客户较为分散，公司业务不存在对单一或少数客户依赖的情形。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东未在上述客户中持有权益。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

报告期内，公司生产运用的原材料包括框架、金、铜、合金丝，塑封料等；生产运用的能源主要是电力。

报告期内，公司成本中原材料、能源构成情况及占比如下：

项目	2013 年		2012 年度	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
框架	24,449,795.79	23.06	26,855,979.31	24.09
金、铜、合金丝	16,866,140.64	15.91	19,305,717.45	17.32
塑封料	7,013,137.18	6.62	7,056,363.66	6.33
电力	3,962,707.49	3.74	3,732,573.11	3.35
合计	52,291,781.10	49.33	56,950,633.53	51.08
总成本	106,009,376.18	100.00	111,489,020.88	100.00

公司自成立以来，原材料及能源供应均较为稳定。

2、公司前五名供应商情况

公司 2013 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额 (元)	占比 (%)
1	宁波华龙电子股份有限公司	16,702,694.70	24.51
2	宁波康强电子股份有限公司	12,100,104.80	17.76
3	北京达博有色金属焊料有限责任公司	5,466,379.49	8.02
4	江阴新杰科技有限公司	4,148,119.06	6.09
5	汉高华威电子有限公司	3,458,829.16	5.08
2013 年度对前五大供应商采购总额合计		41,876,127.21	61.45
2013 年度采购总额合计		68,143,137.49	100.00

公司 2012 年度对前 5 名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额 (元)	占比 (%)
1	宁波华龙电子有限公司	20,852,711.93	28.95
2	宁波康强电子股份有限公司	10,165,890.29	14.11
3	北京达博有色金属焊料有限责任公司	7,823,030.77	10.86
4	汉高华威电子有限公司	4,227,412.14	5.87
5	无锡华友微电子有限公司	3,429,510.21	4.76
2012 年度对前五大供应商采购总额合计		46,498,555.34	64.55
2012 年度采购总额合计		72,034,717.60	100.00

报告期内，公司供应商较为分散，公司业务不存在对单一或少数供应商依赖的情形。

在上述供应商中，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东未在上述客户中持有权益。

(四) 公司重大业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	合同概要	标的金额	对公司持续经营的影响	履行情况
----	------	-------	------	------	------------	------

1	工矿产品购销合同	宁波康强电子股份有限公司	公司向宁波康强电子股份有限公司采购引线框架	3,180,000.00 元	采购原材料, 保证公司产品供应能力	2014年3月18日签订, 该合同已履行完毕
2	工矿产品购销合同	宁波华龙电子股份有限公司	公司向宁波华龙电子股份有限公司采购引线框架	1,394,000.00 元	采购原材料, 保证公司产品供应能力	2014年3月31日签订, 该合同已履行完毕
3	订货合同	北京达博有色金属焊料有限责任公司	公司向北京达博有色金属焊料有限责任公司采购引线框架	708,300.00 元	采购原材料, 保证公司产品供应能力	2013年12月3日签订, 该合同已履行完毕
4	合同(附: 委托代理进口合同)	ASM Pacific(Hong Kong) Limited.; 江苏苏美达国际技术贸易有限公司	公司向 ASM Pacific(Hong Kong) Limited. 采购全自动测试分选机, 由江苏苏美达国际技术贸易有限公司代理买卖和办理进口手续	100,000.00 美元	采购设备, 保证公司产品供应能力	2012年7月6日签订, 该合同已履行完毕
5	封装加工合同	上海贝岭股份有限公司	公司为上海贝岭股份有限公司封装测试芯片, 由对方提供	每月结算一次合同款, 未约定具体合同金额	公司主营业务合同, 增加公司业务收入及利润	2014年2月24日签订, 该合同正在履行过程中

			芯片,公司负责其它封装原材料采购,并封装、测试;完工后,产品销售给对方			
6	委托加工合同	杭州尚格科技有限公司	公司为杭州尚格科技有限公司封装测试芯片,由对方提供芯片,公司负责其它封装原材料采购,并封装、测试;完工后,产品销售给对方	每月结算一次合同款,未约定具体合同金额	公司主营业务合同,增加公司业务收入及利润	2013年12月5日签订,该合同正在履行过程中
7	加工合同	无锡华润矽科微电子有限公司	公司为无锡华润矽科微电子有限公司封装测试芯片,由对方提供芯片,公司负责其它封装原材料采购,并封装、测试;完工后,产品销售给对方	每月结算一次合同款,未约定具体合同金额	公司主营业务合同,增加公司业务收入及利润	2013年1月8日签订,该合同正在履行过程中
8	委托加工协议	杭州展业兴电子有限公司	公司为杭州展业兴电子有限公司	每月结算一次合同款,未约定具体	公司主营业务合同,增加	2013年12月9日签订,该合同正在

			公司封装测试芯片，由对方提供芯片，公司负责其它封装原材料采购，并封装、测试；完工后，产品销售给对方	合同金额	公司业务收入及利润	履行过程中
9	个别合同书	无锡开益禧半导体有限公司	截至2015年末，KEC公司将持续向公司购入产品	量产后，向公司每月最低下达420800美元的订单。	将持续为公司收入及利润带来正面影响	2014年2月签订，该合同正在履行

五、公司的商业模式

半导体器件的封装、测试是公司的主要业务。

公司运用半导体器件封装、测试技术和设备，通过引线框架、金线、塑封胶等原材料的运用，为客户封装、测试半导体器件，并实现销售，取得收入、利润和现金流。

1、销售模式

公司采取多渠道销售模式。具体包括原客户介绍、网络推广、行业协会推荐等。

2、生产模式

公司生产以“半来料加工”为主。体现为芯片由客户提供，引线框架、金线、塑封胶等原材料则由公司采购。产品加工完成后，再销售给提供芯片的客户。

少数状态下，公司亦负责芯片等全部原材料的采购，生产完成后，公司向客户销售产成品。

公司十分注重质量控制，在生产工艺主要流程中，均进行具体质量检验。

3、研发模式

公司研发以客户需求为导向，包括具体具体订单需求产生的订单驱动型研发，以及基于市场趋势判断的前瞻性研发。

4、盈利模式

封装、测试半导体器件，并销售产成品，取得收入、利润、现金流，是公司的主要盈利模

式。

六、所处行业基本情况

（一）行业概况

公司主要从事半导体器件，包括半导体分立器件、集成电路的封装、测试，属于半导体行业中的半导体器件封装子行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C41 其他制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“3824 电力电子元器件制造”。

1、监管体系

公司所处行业的主管部门是国家信息产业部。国家信息产业部负责制订我国半导体封装测试行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

行业引导和服务职能由中国半导体行业协会承担。中国半导体行业协会是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体封装材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位及其它相关的企事业单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会团体，下设集成电路分会、半导体分立器件分会、封装分会、集成电路设计分会和支撑业分会共5个分会。中国半导体行业协会主要负责产业及市场研究，对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、行业特有的经营模式

从事半导体器件封装业务的企业分两类，一类是国际IDM公司设立的全资或控股的封装厂，另一类是专业从事封装的企业，二者的经营模式截然不同。IDM设立的封装厂只是作为集团的一个生产环节，并不独立对外经营，其产品全部返销回母公司，实行内部结算；而专业的半导体器件封装企业则独立对外经营，通常采用典型的来料加工经营模式，接受集成电路芯片设计或制造企业的订单，为其提供封装服务，按封装量收取封装加工费。

3、行业内主要政策

半导体集成电路产业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程，因此受到各国政府的大力支持。

半导体集成电路产业作为国防安全和经济发展的支柱产业，国家给予了高度重视和大力支持。2000年国务院出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发18号文），是集成电路产业的核心政策。财政部、国家税务总局于2002年进一步发布了《关于进一步鼓

励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》(财税[2002]70号),出台了针对集成电路产业更多的税收优惠政策。这两个文件中的增值税“即征即退”政策虽然已于2005年4月取消,但该政策的实施催生了五年来我国集成电路产业年均30%以上的高速发展。

信息产业中大规模集成电路装备制造、新型电子元器件制造被列入《产业结构调整指导目录》(2005年本)鼓励发展的产业。在国家发改委、科学技术部以及商务部2004年联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2004年度)》中,集成电路被列为第十七类。

2005年,国家有关部委联合出台了财建(2005)132号《集成电路产业研究与开发专项基金管理暂行办法》。132号文件被业内称为18号文修改后的重要补充部分,2005年共有1.5亿元专项基金拨出,支持了29个项目。按照该办法,以后每年国家仍将会持续提供资金。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)提出着力发展集成电路、高端服务器等核心基础产业。

2011年12月,工业和信息化部正式发布了《集成电路产业“十二五”发展规划》(工信部规(2011)565号),参照“十一五”时期我国集成电路产业增速、把握集成电路技术及国内外市场发展趋势的基础上,《规划》提出了“十二五”发展的三个基本目标。具体如下:

经济指标:到2015年,销售收入达3300亿元,年均增长18%,满足国内近30%的市场需求。

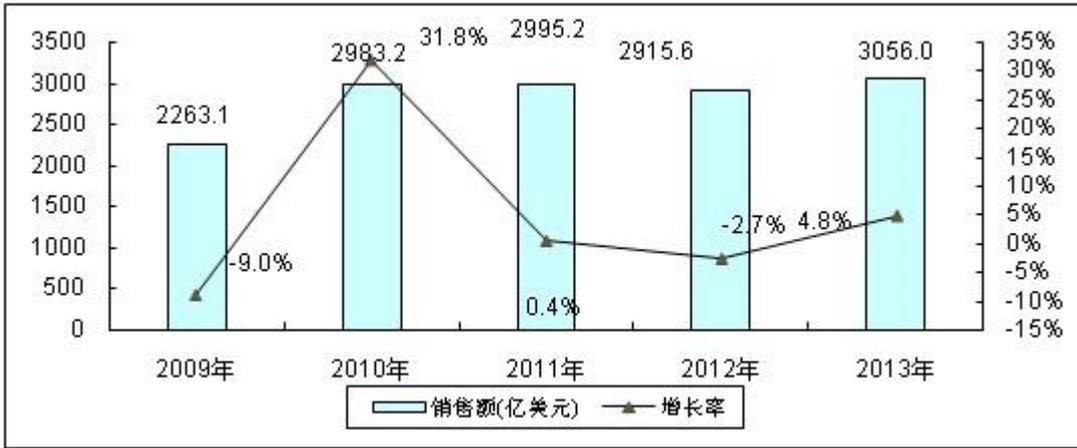
结构目标:包括产业结构、企业结构、区域结构调整目标。特别是突出了培育具有国际竞争力的大企业,到2015年,5~10家设计企业销售收入超过20亿元,1家企业进入全球设计企业前十位;1~2家芯片制造企业销售收入超过200亿元;2~3家封测企业销售收入超过70亿元。

创新目标:参考国际半导体技术路线图,从完善产业链、形成产业链各环节良性互动和协调发展的目标出发,制定了芯片设计、芯片制造、封装测试、专用设备、仪器及材料等环节的技术创新目标。

(二) 市场规模

持续的宏观经济形势不景气直接影响到了电子产品消费和更新的速度。但受益于移动互联网、物联网、新能源等热点应用,2013年全球半导体市场实现4.8%的增长,销售规模达到3056亿美元,创下历史最高记录,同时也是半导体产业首次突破3000亿美元大关。

2009年—2013年全球半导体市场市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2014， 2

在全球经济缓慢复苏的影响下，中国电子产品出口规模再创新高，智能移动终端设备成为中国集成电路市场新的应用热点。在国内外多种因素的驱动下 2013 年中国集成电路市场销售规模加速增长，售额增至 9166.3 亿元，增速为 7.1%。

2009年—2013年中国集成电路市场销售额规模及增长率



数据来源：赛迪顾问 2014， 2

2013 年中国 GDP 增速 7.7%，未来国民经济稳中向好，对半导体市场需求拉动作用强劲。2013 年中国已经超越美国，成为全世界最大的消费电子市场，此外，亚洲也取代北美，成为消费电子最大区域市场。中国，正开始扮演全球消费电子行业驱动引擎的角色。良好的经济增长态势以及巨大的消费电子市场需求都将极大的促进中国半导体市场的发展。

(三) 基本风险特征

1、行业风险特征

半导体器件封装、测试行业属于典型的加工制造业，全行业利润与原材料、劳动力、生产设备价格密切相关。原材料、劳动力、生产设备价格上涨将给行业内公司业绩带来不利影响。

2、市场风险特征

半导体封装、测试行业是高度市场化的行业，全行业公司均面临价格竞争进一步加剧，全行业净资产收益率进一步下滑的风险。

3、政策风险特征

由于信息产业是目前国家重点支持产业，战略性发展产业，经营风险较小，但国家扶持的系列优惠政策，包括税收、奖励将有可能变化，有政策优势减少的风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

我国半导体器件封装测试业明显呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中由飞思卡尔、英特尔、飞索、松下、富士通、意法半导体、瑞萨、英飞凌等国际大型集成电路企业在华投资设立的封装测试厂无论在规模上还是在技术水平上都居于主导地位。而由于资金和技术因素的限制，大部分内资企业的封装技术与国际大型封装企业相比仍然具有一定的差距，但一批内资封装企业在近几年迅速崛起，其封装规模和技术水平都在不断扩大和提高，并在一些先进封装产品的开发方面取得了显著成果，与国际先进水平的差距正逐步缩小。

公司长期致力于半导体器件的封装与测试，已初具生产规模。公司在行业内的竞争优势及劣势如下：

1、竞争优势

（1）团队优势

经过十多年的发展，公司已逐步培养出一批稳定且经验丰富的经营管理团队和技术团队。近年来，公司中高级管理人员及核心技术人员保持了良好的稳定性。

（2）良好的用户关系和市场销售优势

通过十多年的发展，公司培养了一批稳定的客户群体，为公司每年的销售业绩奠定了良好的基础。同时，公司还积极开拓新客户，并取得了一定的成效。

2、竞争劣势

（1）融资渠道单一，资金实力较弱

与国内外大型企业相比，公司资金实力明显较弱，目前只能通过内部积累和股东投入，从而限制了公司在生产规模、研发、营销等方面的投入，成为制约公司发展的一大瓶颈。

（2）规模尚小，尚未形成规模优势

公司在业内无论是资金规模，还是人员规模，均处于中等水平，与业内领先的半导体封装公司仍然有不小的差距。

在国内半导体器件封装领域，公司整体处于行业中等微偏上游水平。

第三节 公司治理

一、近两年公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会、未设立董事会，但设一名执行董事，未设立监事会，但设一名监事。公司变更名称、住所、经营期限、经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会、执行董事决定存在记录届次不清的情况；有限公司章程未明确规定股东会、董事会或执行董事、监事会或监事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易及关联方资金往来未履行股东会或董事会决策程序；有限公司监事未形成书面的监事工作报告。

股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投融资管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《货币资金管理办法》等内部制度。至此，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

总体来说，公司上述机构和相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其职责。公司职工监事许小弟为职工大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司因成立时间较短，共召开 2 次股东大会、2 次董事会会议、2 次监事会会议，三会运行情况良好。

二、公司董事会对公司现有治理机制建设及运行情况的评估结果

公司目前已经建立的治理机制能够给所有股东提供合适的保护并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；《公司章程》已经载明了公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及章程纠纷时的争议解决机制；关联股东和董事在审议关联交易事项时应当依法进行回避；公司财务管理规范、内控机制健全。董事会认为：公司在报告期内有限公司阶段的公司治理规范，公司整体变更为股份公司后建立的公司治理机制的执行符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司相关内控制度的要求，公司治理机制健全，可以给所有股东提供合适的保护和平等权利。

同时，公司将按照法律、行政法规和公司章程的规定进一步建立健全公司治理机制：

1、公司、股东、董事、监事、高级管理人员应严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投融资管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《货币资金管理办法》等公司规章制度行事。

2、公司将强化内部管理，按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，确保公司财务报告真实可靠及行为合法合规。

3、公司与关联方进行关联交易时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，根据法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，履行相应的审议程序。

4、公司将采取有效措施，防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

1、社保缴纳情况

公司现有员工及实习生 318 人，其中缴纳社保人数 241 人，聘用退休人员 4 人，劳务派遣 6 人，实习生 12 人。因此截至 2014 年 5 月 4 日，公司应缴而未缴纳社保人数为 55 人。截至本公开转让说明书签署时，公司存在未按《劳动法》、《劳动合同法》及其它相关法律法规的规定缴纳社保的情形。

公司未严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及其它相关法律法规的规定为员工缴纳社保，主要是因为公司为劳动密集型企业，一线生产员工数量众多且流动性大，甚至存在公司未来得及为员工开立社保账户，该员工即已离职的情形；由于流动频繁，且社保费用有相当部分为员工承担，部分一线员工对缴纳社保存在排斥情绪，公司说服其缴纳社保存在一定困难。

公司承诺将尽快规范员工流程及社保缴纳手续。

公司控股股东、实际控制人王福泉承诺：公司因未按规定与员工签订劳动合同、缴纳社保所致的任何损失，由王福泉向公司补偿。

2、滞纳金

2011 年 12 月，公司在研发费用中列支了模具费 444444.44 元，但经无锡地方税务局第三分局审核：此笔模具费已达到固定资产标准，不能一次性税前列支，应按固定资产要求管理，故应调增企业所得税及研发费用加计扣除额，即 $444444.44 + 444444.44 * 50\% = 666666.66$ 元，公

司需补缴企业所得税 $666666 \times 15\% = 100000$ 元，同时缴纳企业所得税 10 万元的滞纳金 2850 元。该笔所得税及滞纳金，公司已于 2012 年 7 月 30 日缴清。

该笔滞纳金属于公司财务处理不当所致，不涉及重大违法违规行为。

除上述事项外，公司自设立以来，遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

四、公司独立性情况

（一）业务独立

公司的主要业务是半导体分立器件、集成电路的封装、测试及销售。公司致力于动漫、数字多媒体、室内建筑设计与装饰的综合运用，为建筑游历、科普展览、工业展示、军事模拟、文化传播等领域设计并实施多媒体展示的解决方案，面向市场独立经营。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、销售系统，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

（二）资产独立

公司主要资产均合法拥有，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。

（三）人员独立

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

（四）机构独立

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。本公司下设采购部、办公室、市场部、财务部、质量部、技术部、设备部、生产部等八个一级职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立

做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况；公司财务独立。

五、同业竞争情况

公司控股股东为王福泉，实际控制人为王福泉、魏丽娟夫妇。截至本公开转让说明书签署日，王福泉、魏丽娟夫妇对外投资情况具体如下表：

序号	公司名称	持股比例	经营范围
1	玉祁红光	王福泉直接持有其100.00%股权	电子元器件、变压器、电讯电器、电源整机的制造及加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。**（上述经营范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
2	鸿昕电子	玉祁红光持有其55.00%股权	微电子产品开发、集成电路、电力电子元器件、塑料封装、机械零部件设计、制造、销售。
3	蓝箭电子	魏丽娟持有其100.00%股权	电子器材、PVC塑料管的制造、加工。

1、玉祁红光基本情况及与公司同业竞争情况

玉祁红光成立于1997年5月19日，注册资本为人民币800.00万元。主营业务为半导体器件，包括半导体分立器件、集成电路的封装、测试。

玉祁红光与公司从事同一业务，但产品细分领域不同。公司产品主要是贴片式半导体器件、集成电路，产品具有薄、小、微型化、集成度高、低电功率的特点，主要应用于消费类电子产品，包括手机、彩电、MP3、笔记本电脑等领域；玉祁红光产品主要是大型半导体器件，具有体积大、大功率、大电流的特点，主要应用于大电功率设备，如节能灯、充电器等设备。玉祁红光产品与公司产品在生产设备使用、工艺流程上亦不相同。

2014年4月30日，江苏省半导体行业协会出具《证明》内容如下：

“无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“红光微”）与无锡市玉祁红光电子有限公司（以下简称“玉祁红光”）为我会成员企业。我会十分了解红光微、玉祁红光主营业务。

玉祁红光与红光微主营业务均是半导体器件的封装、测试，但两家公司产品细分领域不同。红光微产品主要是贴片式半导体器件、集成电路，产品具有薄、小、微型化、集成度高、低电功率的特点，主要应用于消费类电子产品，包括手机、彩电、MP3、笔记本电脑等领域；玉祁红光产品主要是大型半导体器件，具有体积大、大功率、大电流的特点，主要应用于大功率设

备，如节能灯、充电器等设备。

红光微产品与玉祁红光产品在生产设备使用、生产工艺上亦不相同。玉祁红光的现有生产设备、生产工艺无法生产红光微产品；红光微生产设备、生产工艺亦无法生产玉祁红光产品。

根据我会的了解，玉祁红光产品、红光微产品无论是产品用途、生产设备使用，还是生产工艺上，均不相同，二者不具有相互替代性。我会认为红光微与玉祁红光在生产经营上不构成业务竞争关系。”

为避免出现潜在同业竞争，2014年4月29日，王福泉、玉祁红光做出如下承诺：

(1) 玉祁红光将专注于大型半导体器件的封装、测试及销售，不从事红光微所从事的小型半导体器件封装、测试、销售业务。玉祁红光违反本承诺所获取的全部收益归红光微所有。为督促玉祁红光履行本承诺，红光微在股转系统挂牌后玉祁红光并入红光微前，玉祁红光将每年接受有关主营业务的专项审计，核查玉祁红光是否违反本承诺，并将审计报告交送红光微，由红光微连同拟披露的红光微年报一并在股转系统公司指定的平台披露。审计机构为红光微指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所，审计费用由红光微承担。

(2) 截至本承诺出具时，玉祁红光处于较为严重亏损的状态。玉祁红光资产缩水的主要原因是按照新会计准则，需计提大量应收账款减值损失。为避免玉祁红光拖累红光微经营，玉祁红光暂不并入红光微。

(3) 给予玉祁红光两年左右的催收账款时间。待玉祁红光经营状况好转，应收账款催收结果确定，玉祁红光将并入红光微，并入方式为红光微向王福泉全资收购玉祁红光 100% 股权，收购后，玉祁红光成为红光微全资子公司。王福泉承诺在 2016 年下半年，将玉祁红光全部股权按玉祁红光以 2016 年 6 月 30 日为基准日经评估的净资产值转让给红光微，即王福泉按 1 元评估净资产作价 1 元的价格向红光微转让玉祁红光全部股权。相关审计、评估机构为具有证券期货从业资格的会计师事务所、资产评估公司，具体由红光微指定，并由红光微承担审计、评估费用。

2、鸿昕电子基本情况及与公司同业竞争情况

鸿昕电子成立于 2004 年 4 月 29 日，注册资本为人民币 300.00 万元。主营业务为半导体芯片及电子原件生产与销售。主要产品为半导体芯片。

鸿昕电子为公司上游企业，与公司不存在同业竞争关系。

鸿昕电子为玉祁红光控股子公司，王福泉根据承诺将玉祁红光全部股权转让给公司后，鸿昕电子将一并整合进公司。

3、蓝箭电子基本情况及与公司同业竞争情况

蓝箭电子成立于 2006 年 3 月 20 日，为个人独资企业，投资总额为人民币 40 万元。主营业务为 PVC 管的生产与销售。

蓝箭电子与公司不存在同业竞争关系。

4、为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人所作承诺

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人于 2014 年 4 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东/实际控制人。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、除已披露的情形外，本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司尚未履行完毕的担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡红光微电子股份有限公司、王福泉	玉祁红光	中国农业银行股份有限公司惠山支行	5,000,000.00	2012年7月5日	2016年7月4日	否
无锡红光微电子股份有限公司、王福泉、魏丽娟	玉祁红光	中国银行股份有限公司惠山支行	5,000,000.00	2013年5月27日	2017年5月26日	否

玉祁红光向中国银行股份有限公司无锡惠山支行、中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行分别贷款 500 万元，公司作为保证人分别向该两家银行为玉祁红光提供最高额为 500 元的还款担保。玉祁红光为公司控股股东王福泉控制的其它企业。

玉祁红光向中国银行股份有限公司惠山支行的 500 元贷款中，除红光微担保外，玉祁红光以自有土地使用权及地上厂房向中国银行股份有限公司惠山支行提供最高额为 600 万元的抵押担保，该土地及房产评估价值总计为 977.88 万元。

除上述情况外，公司未对外提供其它担保。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股权情况如下：

序号	股 东	职 务	持股数额(股)	持股比例 (%)
1	王福泉	董事长、总经理	28,640,200	89.00
2	魏丽娟	董事	3,218,000	10.00
3	任耀进	董事、副总经理	320,180	1.00
合计		—	32,180,000	100.00

上述人员中，王福泉、魏丽娟为夫妻关系。

截止本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未以间接方式持有公司股权。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》，

以及有关知识产权保密的《知识产权保护协议》，合同详细规定了上述人员在诚信、尽职、知识产权保密方面的责任和义务。

2014年4月7日，公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

“本人作为无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股东、董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易做出如下承诺：

本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

2014年4月23日，公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，除已披露的情形外，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订重要协议或作出重要承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与公司的关联关系
王福泉	董事长、总经理	玉祁红光执行董事	实际控制人王福泉控股的其它企业
任耀进	董事、副总经理	——	——
陶光亮	董事、副总经理	——	——
魏丽娟	董事	蓝箭电子总经理	实际控制人魏丽娟控股的其它企业

		玉祁红光总经理	实际控制人王福泉控股的其它企业
蔡振华	董事	玉祁红光副总经理	实际控制人王福泉控股的其它企业
陈璐	监事会主席	---	---
唐良	监事	---	---
许小弟	职工监事	---	---
任泉明	财务负责人	---	---

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

(七) 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、董事变动情况

2012年初至2013年9月，公司未设董事会但设一名执行董事，执行董事为王福泉。股份公司第一届董事会成立于2013年9月。近两年公司董事变动情况如下：

时间	董事情况	变动原因
2013.9.9-至今	王福泉、魏丽娟、任耀进、陶光亮、蔡振华	股份公司第一届董事会成立

2013年9月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王福泉、魏丽娟、任耀进、陶光亮、蔡振华为公司董事，组成股份公司第一届董事会。

2013年9月9日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举王福泉为股份公司第一届董事会董事长。

2、监事变动情况

2012年初至2013年3月，有限公司仅设1名监事，为王伯权。

2013年4月至2013年9月，因王伯权去世，公司监事会未选举新监事，公司监事一职空缺。

股份公司第一届监事会成立于2013年9月。近两年监事变动情况如下：

时间	监事情况	变动原因
----	------	------

2013.4.1-2013.9.9	空缺	公司监事王伯权去世，公司未选举新监事
2013.9.9-至今	陈璐、唐良、许小弟	股份公司第一届监事会成立

2013年9月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举陈璐、唐良为公司监事，并与职工代表大会选举产生的职工监事许小弟组成公司第一届监事会。

2013年9月9日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举陈璐为股份公司第一届监事会监事会主席。

3、高级管理人员的变动情况

2012年初至2013年9月，有限公司总经理为王福泉，副总经理为任耀进、陶光亮，财务负责人为任泉明。近两年公司高级管理人员变动情况如下：

时间	总经理	财务负责人	副总经理	变动原因
2013.9.9-至今	王福泉	任泉明	任耀进、陶光亮	股份公司成立，聘任总经理、财务负责人、副总经理

2013年9月9日，股份公司第一届董事会第一次会议，决议聘任王福泉为公司总经理，任泉明为公司财务负责人，任耀进、陶光亮为公司副总经理。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2012 年度及 2013 年度的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》【瑞华审字[2014]31120006 号】。

二、最近两年的主要财务报表

（一）最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及股东权益变动

资产负债表

单位：元

资 产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,947,665.14	2,466,273.23
交易性金融资产		
应收票据	680,341.00	890,000.00
应收账款	42,177,949.25	37,285,904.26
预付款项	528,023.97	579,573.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,013,080.64	4,103,704.46
存货	16,180,663.61	15,183,565.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,434.52	177,131.15
流动资产合计	71,699,158.13	60,686,151.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	94,584.00	133,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,150,000.00	5,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	56,212,722.76	64,051,317.17
在建工程	12,525,900.00	5,532,000.00
工程物资		
固定资产清理	9,487.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,749,119.39	1,795,048.13

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	825,843.35	637,481.83
其他非流动资产	73,500.00	82,500.00
非流动资产合计	76,641,156.83	77,381,827.13
资产总计	148,340,314.96	138,067,978.87

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,500,000.00	
应付账款	45,436,036.02	42,569,425.08
预收款项	296,731.94	201,282.67
应付职工薪酬	1,736,760.79	1,625,561.00
应交税费	836,661.89	828,516.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,122,948.71	23,100,939.55
一年内到期的非流动负债	3,532,491.42	4,468,520.66
其他流动负债		
流动负债合计	104,461,630.77	95,794,316.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,318,359.55	1,970,042.07
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,318,359.55	1,970,042.07
负债合计	107,779,990.32	97,764,358.47
股东权益：		
实收资本（股本）	32,180,000.00	22,180,000.00
资本公积	5,835,530.14	-23,632.00
减：库存股		
盈余公积		3,511,200.08
未分配利润	2,544,794.50	14,636,123.41

外币报表折算差额		
股东权益合计	40,560,324.64	40,303,691.49
负债及股东权益合计	148,340,314.96	138,067,978.87

利润表

单位:元

项 目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	125,666,100.79	129,775,938.52
减：营业成本	106,009,376.18	111,489,020.88
营业税金及附加	839,258.70	742,364.56
销售费用	1,219,423.50	1,420,282.35
管理费用	13,320,895.25	10,555,246.30
财务费用	3,585,099.88	3,453,744.57
资产减值损失	1,284,336.90	514,008.25
加：公允价值变动收益		
投资收益	211,040.31	152,927.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-381,249.31	1,754,199.45
加：营业外收入	1,655,564.74	1,097,500.00
减：营业外支出	64,000.04	58,313.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	1,210,315.39	2,793,386.35
减：所得税费用	-55,473.56	296,714.88
四、净利润	1,265,788.95	2,496,671.47
归属于母公司股东的净利润		
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08
六、其他综合收益	-38,896.00	6,888.00
七、综合收益总额	1,226,892.95	2,503,559.47

现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
	合并	合并
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,275,922.84	150,335,654.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,906,545.01	14,010,648.39
经营活动现金流入小计	169,182,467.85	164,346,303.36
购买商品、接受劳务支付的现金	97,856,780.65	105,969,118.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,799,953.09	14,759,793.86
支付的各项税费	7,008,867.12	6,501,095.50
支付其他与经营活动有关的现金	24,693,800.17	22,924,963.22
经营活动现金流出小计	144,359,401.03	150,154,970.93
经营活动产生的现金流量净额	24,823,066.82	14,191,332.43
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	211,040.31	152,927.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,111.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	497,151.42	152,927.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,142,360.40	20,432,280.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,142,360.40	20,432,280.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,645,208.98	-20,279,352.47
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,770,000.00	29,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,770,000.00	29,330,000.00

偿还债务支付的现金	42,400,000.00	23,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,566,465.93	3,646,808.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,966,465.93	26,956,808.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,196,465.93	2,373,191.89
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	4,981,391.91	-3,714,828.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,466,273.23	6,181,101.38
六、期末现金及现金等价物余额	7,447,665.14	2,466,273.23

2013 年度股东权益变动表

单位:元

项 目	2013 年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,180,000.00	-23,632.00		3,511,200.08	14,636,123.41	40,303,691.49
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	22,180,000.00	-23,632.00		3,511,200.08	14,636,123.41	40,303,691.49
三、本年增减变动金额	10,000,000.00	5,859,162.14		-3,511,200.08	-12,091,328.91	256,633.15
(一) 净利润					1,265,788.95	1,265,788.95
(二) 其他综合收益		-5,791.00				-5,791.00
(三) 股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				189,868.34	-1,160,128.14	-970,259.80
1. 提取盈余公积				189,868.34	-189,868.34	
2. 对股东的分配					-970,259.80	-970,259.80
3. 其他						
(五) 股东权益内部结转	10,000,000.00	5,864,953.14		-3,701,068.42	-12,196,989.72	-33,105.00
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	10,000,000.00	5,864,953.14		-3,701,068.42	-12,196,989.72	-33,105.00
四、本年年末余额	32,180,000.00	5,835,530.14		0.00	2,544,794.50	40,560,324.64

2012年度股东权益变动表

单位:元

项 目	2012 年度					
	实收资本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,180,000.00	-30,520.00		3,136,699.36	12,513,952.66	37,800,132.02
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	22,180,000.00	-30,520.00		3,136,699.36	12,513,952.66	37,800,132.02
三、本年增减变动金额		6,888.00		374,500.72	2,122,170.75	2,503,559.47
（一）净利润					2,496,671.47	2,496,671.47
（二）其他综合收益		6,888.00				6,888.00
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				374,500.72	-374,500.72	
1. 提取盈余公积				374,500.72	-374,500.72	
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	22,180,000.00	-23,632.00		3,511,200.08	14,636,123.41	40,303,691.49

注：下文引用的财务数据，如未经说明，均为合并报表数。

（二）公司财务报表编制基础、最近两年合并财务报表范围及变化情况

1、公司财务报表编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、最近两年合并财务报表范围及变化情况

无。

三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响

（一）主要会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

4、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
 公司将金额为人民币 30 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	应收款项的账龄

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	2.00	2.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

注：计提坏账准备的说明，公司对其他应收款项中的备用金、押金等款项，考虑到其信用风险不大，一般不计提坏账准备。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

5、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

6、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益

的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 处置长期股权投资

对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00
办公家具	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00
食堂设备	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 11 “非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如

发生改变则作为会计估计变更处理。

8、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见 11 “非流动非金融资产减值”。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 11 “非流动非金融资产减值”。

11、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信

息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、收入

商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

收入确认方法

公司产品在发出后取得对方验收单后确认收入。

13、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存

在相关递延收益的，直接计入当期损益。

14、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二) 重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、重大会计政策、会计估计的变更

本报告期内无会计政策、会计估计的变更。

2、前期会计差错更正

本报告期内未发生前期会计差错的更正。

(三) 重大会计政策、会计估计与可比公司的差异对公司利润的影响

公司主要会计政策与同行业上市公司长电科技（600584）在固定资产折旧方面存在一定差异。长电科技的专用设备折旧年限为 8 年，公司与长电科技同类的专用设备统一在电子设备核算，折旧年限为 5 年。假定公司与同行业上市公司按同样的会计政策核算，报告期内将调增公司税前利润约 470 万元每年。

四、最近两年的主要会计数据和财务指标

项目	2013.12.31	2012.12.31
----	------------	------------

资产总计（万元）	14,834.03	13,806.80
负债总计（万元）	10,778.00	9,776.43
股东权益合计（万元）	4,056.03	4,030.37
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	4,056.03	4,030.37
每股净资产（元）	1.26	1.82
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.26	1.82
资产负债率	72.66%	70.81%
流动比率（倍）	0.69	0.63
速动比率（倍）	0.53	0.48
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	12,566.61	12,977.59
净利润（万元）	126.58	249.67
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	126.58	249.67
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-9.66	161.22
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-9.66	161.22
毛利率（%）	15.64	14.09
净资产收益率（%）	3.24	6.17
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.25	3.99
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08
应收账款周转率（次）	3.02	3.44
存货周转率（次）	6.76	7.10
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,482.31	1,419.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77	0.64

注：公司 2012 年为有限责任公司，2012 年每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标中“股本数”均按公司股改后注册资本作为股本模拟计算。

（一）财务状况分析

1、盈利能力分析

2013 年、2012 年公司收入分别为 12,566.61 万元、12,977.59 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-9.66 万元、161.22 万元，均呈下降趋势。公司收入下降的主要原因是为了提高公司效益，公司主动减少了毛利率为负的产品的销售，转向生产毛利较高产品所致。加上公司主要原材料价格有一定程度下降，公司 2013 年度毛利较 2012 年度上升了 136.98 万元。但是由于管理费用上升的幅度高于毛利上升的幅度，公司营业利润有所下降，扣非后净利润由盈利转为亏损。公司的非经常性损益主要为江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金，加上非经常性损益后，公司 2013 年、2012 年实现净利润 126.58

万元、249.67 万元。

公司 2012 年度、2013 年度净资产收益率分别为 6.17%、3.24%。2013 年净资产收益率略有下降主要是因为公司 2013 年公司净利润略有下降。总体来说，公司的净资产收益率不高，盈利能力一般。

2、偿债能力分析

公司 2012 年末、2013 年末的流动比率分别为 0.63、0.69，流动比例偏低。公司 2012 年末、2013 年末的速动比率分别为 0.48、0.53，短期偿债能力较弱。公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日资产负债率分别为 70.81%、72.66%，资产负债率较高。总体来说，公司偿债能力不强，主要原因一是公司采取债权融资的方式进行大量固定资产投资，包括新建厂房和购买设备，导致公司负债率较高，且资产期限与负债期限不配比。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共向银行借款 2800 万元，向自然人借款 713 万元。公司目前大规模的投资计划已经基本完成，未来的主要的投资资金需求是后续付款及更新机器设备。预期公司未来经营活动现金流量能够覆盖设备更新。因此，目前公司债权融资规模已经基本稳定。公司税息前利润能够覆盖融资成本。此外，公司关联借款人做出承诺，不会在影响公司正常经营的情况下，要求公司偿还借款。

3、营运能力分析

公司 2012 年度、2013 年度的应收账款周转率分别为 3.44、3.02，两年相比变化不大。2013 年度较 2012 年度略有下降，主要原因系公司部分主要客户 2013 年度起延长了对公司付款周期。

公司 2012 年度、2013 年度的存货周转率分别为 7.10 和 6.76。存货周转速度较快，公司两年的存货周转率变化不大。

总体来说，公司应收账款周转速度较同行业上市公司低，公司应收账款管理水平有待进一步加强。公司存货周转率与同行业上市公司差距不大。

4、现金流量分析

公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,419.13 万元，2013 年度经营活动产生的现金流量净额为 2,482.31 万元，较 2012 年度上升 74.92%，主要原因是经营性应付项目上升了 1,394.81 万元。

公司 2012 年度、2013 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-2,027.94 万元、-1,664.52 万元。公司报告期内投资新建了二期厂房以进一步扩大生产。同时，公司的设备也在稳定的更新中。预计公司在未来一年仍然有大规模的固定资产投资活动。

公司 2012 年度、2013 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 237.32 万元、-319.65 万元。公司 2012 年度、2013 年度均向银行新增借款 500 万元，2013 年筹资活动产生的现金流量为负的主要原因是公司的偿还债务支付的现金有所增加，同时支付的财务费用及股东分红也有所上升。

（二）营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、营业收入构成、比例（按品种分类）

营业收入	2013年度		2012年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	125,075,100.79	99.53	128,862,104.49	99.30
T0-92	14,712,218.92	11.71	21,116,036.94	16.28
T0-220	4,911,843.71	3.91	4,444,398.33	3.42
SOT	98,901,000.33	78.70	102,234,755.68	78.78
T0-252	4,301,481.50	3.42	953,202.60	0.73
SOP8	2,248,556.33	1.79	113,710.94	0.09
其他业务收入	591,000.00	0.47	913,834.03	0.70
合计	125,666,100.79	100.00	129,775,938.52	100.00

公司的主营业务收入主要来自于半导体器件，包括半导体分立器件、集成电路的封装、测试。

公司 2013 年度主营业务收入较 2012 年度下降了 2.94%。其中 T0-92 收入下降最多，，主要由于 T0-92 属于相对比较老的工艺，市场竞争比较激烈，2012 年、2013 年产品毛利均为负值，且市场价格有进一步下滑趋势。为了提高公司效益，公司主动减少了该产品的销售，并将产能转向较高附加值产品。SOT 为公司目前最大的产品品种，公司近几年的新增产能基本上都集中于该品种，2013 年比 2012 年略有下降，属于正常波动。T0-220 的封装体积最大，单价最高，同时成本也最高，公司该条生产线产能较小，基本上满负荷运转，2013 年收入较 2012 年有所上升，总体来说变化较小。2012 年 T0-252、SOP8 两个品种的收入很少，2013 年尽管仍然属于比较小的品种，但是收入上升幅度较高。

公司其他业务收入主要为场地租金和废品出售收入，2012 年、2013 年分别为 913,834.03 元、591,000.00 元。其他业务收入下降主要受 2013 年产生的废品较少所致。

2、营业利润、利润总额及净利润

公司最近两年的营业利润、利润总额及净利润情况如下表：

项目	2013年度		2012年度
	金额（元）	变化率（%）	金额（元）
营业收入	125,666,100.79	-3.17	129,775,938.52

营业成本	106,009,376.18	-4.91	111,489,020.88
毛利	19,656,724.61	7.49	18,286,917.64
营业利润	-381,249.31	-121.73	1,754,199.45
利润总额	2,210,315.39	-20.87	2,793,386.35
净利润	1,265,788.95	-49.30	2,496,671.47

公司 2012 年度、2013 年度营业利润分别为 1,754,199.45 元、-381,249.31 元。公司本身利润不高，较接近盈亏平衡点，收入、成本、费用的较小变化就会造成公司业绩的波动。2013 年公司毛利率较 2012 年略有上升，因此毛利也略有提高，但是由于管理费用上升的幅度高于毛利上升的幅度，公司营业利润有所下降，由盈利转为亏损。加上公司的非经营性损益后，公司 2012 年和 2013 年均实现了小幅盈利。

3、毛利率的构成

毛利率	2013年度 (%)	2012年度 (%)
T0-92	-17.93	-11.85
T0-220	29.37	27.42
S0T	19.09	18.08
T0-252	33.50	24.74
SOP8	-2.73	-52.36
合计	15.24	13.48

公司 2013 年度、2012 年度的毛利率分别为 15.24%和 13.48%。2013 年度公司毛利率较 2012 年度上升了 11.56%。主要原因为 2013 年国际大宗商品价格下降，公司的主要原材料，铜框架，金线价格有所下降，使得毛利有所上升。

(三) 主要费用占营业收入的比重及变化情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度	增长率 (%)	2012 年度
销售费用(元)	1,219,423.50	-14.14	1,420,282.35
管理费用(元)	13,320,895.25	26.20	10,555,246.30
研发费用(元)	6,791,735.78	24.95	5,435,561.43
财务费用(元)	3,585,099.88	3.80	3,453,744.57
销售费用占营业收入比重 (%)	0.97	-11.33	1.09
管理费用占营业收入比重 (%)	10.60	30.33	8.13
研发费用占营业收入比重 (%)	5.40	29.04	4.19
财务费用占营业收入比重 (%)	2.85	7.20	2.66
费用占营业收入比重 (%)	14.42	21.28	11.89

公司销售费用主要包括销售人员职工薪酬、差旅费及办公费等。2012 年度、2013 年度公司销售费用占比均较低。2013 年公司销售费用下降的原因主要是公司通过与快递公

司谈判，降低了快递费收费标准，2013年快递费较2012年下降了26.83万元。

公司管理费用主要包括研发费用、工资及社保、业务招待费等，公司2013年管理费用较2012年上升276.56万元，主要是一、公司的研发费用上升较快，2013年研发费较2012年增加了135.62万元；二、工资社保有一定的自然增长，增长了30.71万元；三、公司因拟在全国中小企业股转公司挂牌，审计顾问费有一定的增长，增长了23.74万元。此外，由于公司处于新建厂房，洽谈扩大产能时期，业务招待费和各类杂费也有一定上升。

公司2012年度、2013年度的财务费用分别为3,453,744.57元、3,585,099.88元。公司的财务费用主要为支付银行及向个人借款的利息、企业融资租入固定资产产生的利息费用。

（四）重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益及非经常性损益情况

（1）投资收益明细

单位：元

项目	2013年	2012年
成本法核算的长期股权投资收益	211,040.31	152,927.84
合计	211,040.31	152,927.84

公司投资收益为公司投资的无锡农村商业股份有限公司的股息。

（2）非经常损益明细

单位：元

项目	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益	104,222.25	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,550,500.00	1,097,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,157.55	-58,313.10
非经常性损益总额	1,591,564.70	1,039,186.90
减：非经常性损益的所得税影响数	229,134.70	154,670.45
非经常性损益净额	1,362,430.00	884,516.45
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,362,430.00	884,516.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-96,641.05	1,612,155.02
非经常性损益净额占净利润的比重（%）	107.63	35.43

公司2012年度、2013年度非经常性损益以政府补助为主，明细情况如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
----	--------	--------

江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,500,000.00	1,000,000.00
专利资助和奖励	50,500.00	37,500.00
半导体封装测试清洁生产补助		60,000.00
合计	1,550,500.00	1,097,500.00

2013 年度、2012 年度公司发生非经常性损益占同期净利润的比例分别为 107.63%、35.43%。公司非经常性损益占净利润的比例较高，公司对非经常性损益存在较大依赖。

2、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

(1) 适用的税收优惠政策

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GR201032000469 号《高新技术企业证书》，本公司按《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定为国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。即 2011 年至 2013 年减按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

(2) 公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育附加费	实际缴纳流转税	2%

(五) 报告期内各期末主要资产情况

1、应收票据

单位：元

种类	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	680,341.00	890,000.00
合计	680,341.00	890,000.00

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无应收票据用于贴现或质押。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	382,005.00	0.86	382,005.00	382,005.00	0.98	382,005.00
按账龄组合计提坏	43,169,924.30	97.51	991,975.05	38,222,244.59	97.87	936,340.33

账准备的应收账款						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	722,008.91	1.63	722,008.91	448,261.06	1.15	448,261.06
合计	44,273,938.21	100.00	2,095,988.96	39,052,510.65	100.00	1,766,606.39

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款分布如下：

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备(元)	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
1年以内	41,207,784.42	95.46	824,155.69	34,605,025.01	90.53	692,100.50
1至2年	1,079,851.82	2.50	53,992.59	2,812,428.37	7.36	140,621.42
2至3年	645,086.34	1.49	64,508.63	573,398.32	1.50	57,339.83
3至4年	230,942.48	0.54	46,188.50	231,392.89	0.61	46,278.58
4至5年	6,259.28	0.01	3,129.64			
合计	43,169,924.34	100.00	991,975.05	38,222,244.59	100.00	936,340.33

公司2013年应收账款较2012年增长13.12%，主要原因是：2013年公司对一些老客户放宽了信用期，如杭州尚格科技有限公司，2012年度采用月结60天内付款，2013年公司与该客户业务量大幅增加，且长期的合作关系也使彼此之间建立了信任度，公司将信用期放宽到月结90天内付款。2012年末公司对杭州尚格应收账款期末余额为1,413,923.81元，2013年末公司对杭州尚格应收账款期末余额为6,192,239.04元，变动金额为4,778,315.24元。

2013年12月份收入金额较其他月份有所增加，由此2013年末应收账款余额增加。公司2013年度主营业务收入为125,075,100.79元，月平均收入为10,422,925.06元，2013年12月主营业务收入金额为11,172,123.71元，较月平均收入增加了749,198.64元。

根据公司历年的应收账款回收情况，公司制定了较为稳健的会计政策，对应收账款提取了相应的坏账准备。具体计提标准见公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响”。根据公司管理层估计，金额未达到重要性标准，但是可能无法收回的应收账款合计722,008.91元，全额提取了坏账准备。

截至2013年12月31日，应收账款账龄在1年以内的比例为93.07%，账期较短。

截至2013年12月31日应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

截至2012年12月31日、2013年12月31日，应收账款金额前五名单位情况如下：

2013年12月31日

单位名称	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	账龄
北京确实科技股份有限公司	8,926,687.42	20.16	1年以内
杭州尚格科技有限公司	6,192,239.04	13.99	1年以内
吉林华微电子股份有限公司	3,458,454.20	7.81	1年以内
苏州智浦芯联电子科技有限公司	3,105,372.88	7.01	1年以内
上海贝岭股份有限公司	2,673,790.01	6.04	1年以内
合计	24,356,543.55	55.01	

2012年12月31日

单位名称	金额(元)	占应收账款总额的比例(%)	账龄
上海贝岭股份有限公司	6,598,706.86	16.81	1年以内
北京确实科技股份有限公司	5,001,391.03	12.74	1年以内
吉林华微电子股份有限公司	3,786,438.02	9.64	1年以内
中国华大集成电路设计集团有限公司	2,052,826.83	5.23	1年以内
深圳市弘聚升电子有限公司	1,678,211.10	4.27	1年之内 1-2年
合计	19,117,573.84	48.69	

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	528,023.97	100.00	579,573.02	100.00
合计	528,023.97	100.00	579,573.02	100.00

2012年12月31日, 预付账款 579,573.02 元, 2013年12月31日, 预付账款为 528,023.97 元, 减少 8.89%。公司预付账款金额较低。

2013年12月31日预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

截至2012年12月31日、2013年12月31日, 预付账款前五位的情况如下:

2013年12月31日

单位名称	金额(元)	占预付款总额的比例(%)	账龄	与公司关系	款项性质
无锡新区供电营业厅	232,504.91	44.03	1年以内	非关联方	预付电费
常州三井防静电有限公司	110,000.00	20.83	1年以内	非关联方	预付材料款
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	101,760.00	19.27	1年以内	非关联方	预付审计费
上海市合成树脂研究所	39,800.00	7.54	1年以内	非关联方	预付材料款
无锡亿仁电子有限公司	14,149.06	2.68	1年以内	非关联方	预付材料款

合计	498,213.97	94.35			
----	------------	-------	--	--	--

2012年12月31日

单位名称	金额(元)	占预付款总额的比例(%)	账龄	与公司关系	款项性质
无锡新区供电营业厅	253,729.87	43.78	一年以内	非关联方	预付电费
苏州斯尔特微电子有限公司	200,000.00	34.51	一年以内	非关联方	预付材料款
上海市合成树脂研究所	79,600.00	13.73	一年以内	非关联方	预付材料款
苏州大学卫生与环境技术研究所	15,000.00	2.59	一年以内	非关联方	预付环评费
深圳市正易新材料有限公司	13,800.00	2.38	一年以内	非关联方	预付材料款
合计	562,129.87	96.99			

4、其他应收款

种类	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	金额(元)	比例(%)	金额(元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				3,473,639.57	81.42	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	59,500.00	5.20	1,190.00	45,073.30	1.06	1,002.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,084,829.39	94.80	130,058.75	747,635.55	17.52	161,641.85
合计	1,144,329.39	100.00	131,248.75	4,266,384.42	100.00	162,643.96

其他应收款坏账准备具体计提标准见公开转让说明书之“第四节公司财务”之“三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响”。

报告期内公司其他应收款中应收关联方及非关联方的资金拆借款未签署借款协议，未约定利息，未规定偿还期限。对非关联方（秦舒）的拆借款，是由于江苏半导体行业协会举办展会缺少资金，向公司临时借款，公司按照内部决策程序经批准后借出，目前已归还。2014年4月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会和第一届监事会第二次会议上，对关联方（玉祁红光）的拆借款分别予以认可，认为该关联交易未对公司、股东及债权人的利益造成重大不利影响，2013年，公司收回了玉祁红光拆借款。

截至2013年12月31日，其他应收款持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项见公开转让说明书“第四节公司财务”之“关联方、关联方关系及重大关联

方交易情况”。

截至2012年12月31日、2013年12月31日，其他应收款前五位金额情况如下：

2013年12月31日

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
赛锡科技无锡有限公司	265,798.79	23.23	1年以内	非关联方	租赁费
无锡市新区创友融资担保有限公司	250,000.00	21.85	1-2年	非关联方	担保费
秦舒	200,000.00	17.48	1-2年	非关联方	资金拆借
无锡第五建筑工程有限公司	125,466.75	10.96	1-2年	非关联方	水电费
王福泉	75,739.91	6.62	1年以内	关联方	备用金
合计	917,005.49	80.14	-	-	-

2012年12月31日

单位名称	金额（元）	占其他应收款总额的比例（%）	账龄	与公司关系	款项性质
无锡市玉祁红光电子有限公司	2,521,889.57	59.11	一年之内	关联方	资金拆借
赛锡科技（无锡）有限公司	951,750.00	22.31	一年之内 1-2年 2-3年	非关联方	土地租金
无锡市新区创友融资担保有限公司	250,000.00	5.86	一年之内	非关联方	保证金
秦舒	200,000.00	4.69	一年之内	非关联方	资金拆借
无锡第五建筑有限公司	125,466.75	2.94	一年之内	非关联方	水电费
合计	4,049,106.32	94.91			

5、存货

公司的存货分三大类，结构见下表：

单位：元

项目	2013年度		2012年度	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	7,239,265.26	385,707.21	5,964,730.80	315,304.47
在产品	4,771,884.17	33,818.03	4,784,364.82	36,925.42
库存商品	4,893,026.92	303,987.50	5,105,905.51	319,205.62
合计	16,904,176.35	723,512.74	15,855,001.13	671,435.51

公司主要有两种业务，一类是为客户封装芯片，简称为加工业务，该业务涉及的存货主要为原材料、在产品。一类是外购芯片自行加工并出售，简称为自制业务，该业务涉及所有的三类存货。原材料为根据生产含计划统一采购，公司根据多年生产经验，针

对不同类别的原材料采取了不同的采购策略。对于供应价格稳定的原材料，公司一般准备 1-2 周的库存，对于铜框架、金线等价格变动较大的原材料，公司会根据市场价格波动情况增加或者减少备货。2013 年国际金价大幅下降，作为公司的主要原材料之一金线的价格也有所下降，由于金线保存方便，无损毁风险，公司采购了较多金丝备用。因此 2013 年末公司原材料账面余额有所上升。原材料投入后到交货的周期一般为 1 月，公司为保证产能均衡，合理利用现有人力与机器，在产品金额相对稳定。

公司加工业务一般完成生产就送到客户处，不形成库存商品。在加工业务相对较少，有剩余产能时，公司会利用剩余产能生产自制产品。公司的库存商品为自制业务形成，为保证能够在接到订单时及时供货且不影响加工业务，公司自制产品一般准备 4-5 个月的货。公司库存商品金额与公司自制业务开展情况相适应。

综合以上因素，公司 2012 年、2013 年的存货周转率分别为 7.10、6.76。公司的存货规模和公司的生产及销售模式相适应，与公司的订单及销售计划相匹配。

2013 年末，公司针对不同库龄，不同类型的存货分别进行了减值测试，提取了相应的跌价准备 723,512.74 元。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	128,411,284.83	8,397,858.64	871,968.79	135,937,174.68
其中：房屋及建筑物	8,740,601.58	300,000.00		9,040,601.58
机器设备	23,943,022.34	2,112,798.55	682,222.22	25,373,598.67
电子设备	92,895,251.96	5,810,720.23		98,705,972.19
办公设备	429,398.49	30,917.10		460,315.59
办公家具	97,810.00			97,810.00
运输工具	2,144,593.46	143,422.76	189,746.57	2,098,269.65
食堂设备	160,607.00			160,607.00
二、累计折旧合计	64,359,967.66	16,045,076.86	680,592.60	79,724,451.92
其中：房屋及建筑物	2,421,524.03	439,111.75		2,860,635.78
机器设备	8,831,549.73	2,644,919.04	500,333.36	10,976,135.41
电子设备	51,773,879.57	12,616,464.32		64,390,343.89
办公设备	256,494.61	62,624.69		319,119.30
办公家具	89,080.00	3,839.60		92,919.60
运输工具	889,418.89	249,376.34	180,259.24	958,535.99
食堂设备	98,020.83	28,741.12		126,761.95
三、固定资产账面净值合计	64,051,317.17			56,212,722.76
其中：房屋及建筑物	6,319,077.55			6,179,965.80

机器设备	15,111,472.61		14,397,463.26
电子设备	41,121,372.39		34,315,628.30
办公设备	172,903.88		141,196.29
办公家具	8,730.00		4,890.40
运输工具	1,255,174.57		1,139,733.47
食堂设备	62,586.17		33,845.24
四、减值准备合计			
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
办公设备			
办公家具			
运输工具			
食堂设备			
五、固定资产账面价值合计	64,051,317.17		56,212,722.76
其中：房屋及建筑物	6,319,077.55		6,179,965.80
机器设备	15,111,472.61		14,397,463.26
电子设备	41,121,372.39		34,315,628.30
办公设备	172,903.88		141,196.29
办公家具	8,730.00		4,890.40
运输工具	1,255,174.57		1,139,733.47
食堂设备	62,586.17		33,845.24

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司将账面价值约为 5,517,146.88 元（原值 8,181,072.08 元）的房屋、建筑物及设备进行抵押，取得 13,000,000.00 元的短期借款。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
电子设备	14,073,010.38	7,695,292.83	6,377,717.55
合计	14,073,010.38	7,695,292.83	6,377,717.55

公司融资租入的固定资产主要是全自动切筋/弯脚成型系统、全自动银浆固晶机、全自动测试系统、全自动金线焊接机等生产设备。出租方均为恒信金融租赁有限公司。公司与恒信金融租赁有限公司签订融资租赁合同，起租日期在 2010 年或 2011 年两年间，租赁期限 36 个月，每 3 个月付一期租金。恒信金融租赁有限公司拥有融资租赁业务资质。

公司固定资产以房屋建筑物、机器设备、电子设备为主。其中房屋建筑物为公司的一期厂房，正常使用中。机器设备以封装过程中需要的机械类设备为主，如冲床、模具等。电子设备以封装过程中使用的全自动测试系统、全自动金线焊接机、全自动银浆固晶机等设备，行业对电子设备提取折旧的年限一般为 8 年，公司按 5 年提取折旧，折旧较同行业上市公司快。公司的电子设备面临着技术更新换代的风险，因此公司今年来一

直大规模的采购电子设备，未来仍将继续保持一定的电子设备更新换代频率。

7、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期厂房-土建工程	5,315,300.00		5,315,300.00	5,312,000.00		5,312,000.00
二期厂房-机电安装工程	4,140,000.00		4,140,000.00			
二期厂房-空调安装工程	1,554,000.00		1,554,000.00			
二期厂房-隔壁吊顶工程	1,425,000.00		1,425,000.00			
二期厂房-连廊工程	79,600.00		79,600.00			
二期厂房-连廊工程设计	12,000.00		12,000.00			
二期厂房-电梯				220,000.00		220,000.00
合 计	12,525,900.00		12,525,900.00	5,532,000.00		5,532,000.00

(2) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度 (%)	备注
二期厂房-土建工程	100.00	尚处于验收阶段，未达到可使用状态
二期厂房-机电安装工程	90.00	工程进度以投入资金占预算的比重为基础进行估计
二期厂房-空调安装工程	70.00	工程进度以投入资金占预算的比重为基础进行估计
二期厂房-隔断吊顶工程	95.00	工程进度以投入资金占预算的比重为基础进行估计
二期厂房-连廊工程	20.00	工程进度以投入资金占预算的比重为基础进行估计
二期厂房-电梯	100.00	已达到可使用状态

(3) 重大在建工程变动情况

单位：元

工程名称	2012年12月31日	本年增加数	本年转入固定资产数	2013年12月31日
二期厂房-土建工程	5,312,000.00	3,300.00		5,315,300.00

二期厂房-机电安装工程		4,140,000.00		4,140,000.00
二期厂房-空调安装工程		1,554,000.00		1,554,000.00
二期厂房-隔断吊顶工程		1,425,000.00		1,425,000.00
二期厂房-连廊工程		79,600.00		79,600.00
二期厂房-连廊设计		12,000.00		12,000.00
二期厂房-电梯	220,000.00	18,034.19	238,034.19	
合计	5,532,000.00	7,231,934.19	238,034.19	12,525,900.00

单位：元

工程名称	2011年12月31日	本年增加数	本年转入固定资产数	2012年12月31日
二期厂房-土建工程	2,213,600.00	3,098,400.00		5,312,000.00
二期厂房-机电安装工程				
二期厂房-空调安装工程				
二期厂房-隔断吊顶工程				
二期厂房-连廊工程				
二期厂房-连廊设计				
二期厂房-电梯	-	220,000.00		220,000.00
合计	2,213,600.00	3,318,400.00		5,532,000.00

截至本说明书出具之日，公司新建二期厂房已经基本完工，装修装饰也基本完成，公司即将搬入新建厂房生产。未来，随着这一部分产能的释放，公司销售额预期会有一定的提升。截至2013年12月31日，公司共向银行借款2800万元，向自然人借款713万元。公司目前大规模的投资计划已经基本完成，未来的主要是后续付款及更新机器设备。预期公司未来经营活动现金流量能够覆盖设备更新。因此，目前公司债权融资规模已经基本稳定。公司税息前利润能够覆盖融资成本。此外，公司关联借款人做出承诺，不会在影响公司正常经营的情况下，要求公司偿还借款。

8、无形资产

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	2,296,436.84			2,296,436.84
土地使用权	2,296,436.84			2,296,436.84
二、累计摊销合计	501,388.71	45,928.74		547,317.45
土地使用权	501,388.71	45,928.74		547,317.45
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
四、账面价值合计	1,795,048.13		45,928.74	1,749,119.39

土地使用权	1,795,048.13		45,928.74	1,749,119.39
-------	--------------	--	-----------	--------------

公司土地使用权为2002年4月5日取得的无锡新区开发区93#-B-1地块，即目前公司的厂房地址，使用权期限为50年，账面原值按50年摊销。

截至2013年12月31日，公司将账面价值为人民币1,749,119.39元的无形资产土地所有权进行抵押，取得银行借款人民币13,000,000.00元，2013年该土地使用权的摊销额为人民币45,928.74元。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	2012年12月31日	2013年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
无锡农村商业银行股份有限公司	成本法	5,150,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.0976	0.0976
合计	-	5,150,000.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.0976	0.0976

2013年12月31日，公司投资无锡农村商业银行股份有限公司5,150,000.00元，占其股权的0.0976%。

10、资产减值明细

单位：元

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
一、坏账准备	1,929,250.35	1,053,570.46		755,583.10	2,227,237.71
二、存货跌价准备	671,435.51	230,766.44		178,689.21	723,512.74
合计	2,600,685.86	1,284,336.90		934,272.31	2,950,750.45

除上述减值准备以外，公司未对其他资产计提减值准备。

(六) 报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	
合计	28,000,000.00	23,000,000.00

公司抵押借款系以持有的房屋建筑物、土地使用权作为抵押，向无锡农村商业银行股份有限公司新区支行取得抵押借款人民币1,300万元，借款期限自2013年12月20

日至 2014 年 9 月 12 日。利息为基准利率上浮 10%。

公司担保借款包括：①由无锡市科发投资担保有限公司提供连带责任保证担保，向江苏银行股份有限公司无锡新区支行取得担保借款人民币 500 万元，借款期限自 2013 年 9 月 11 日至 2014 年 3 月 8 日。该笔借款由无锡市玉祁红光电子有限公司向无锡市科发投资担保有限公司提供保证反担保。利息为基准利率上浮 10%。②由无锡市新区创友融资担保有限公司提供连带责任保证担保，向招商银行股份有限公司无锡分行取得担保借款人民币 500 万元。该借款由无锡市玉祁红光电子有限公司向无锡市新区创友融资担保有限公司提供保证反担保。该借款分为三笔，其中：200 万元借款，期限自 2013 年 3 月 6 日至 2014 年 3 月 5 日；200 万元借款，期限自 2013 年 9 月 16 日至 2014 年 3 月 16 日；100 万元借款，期限自 2013 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 14 日。利息为基准利率上浮 10%。

公司质押借款系由无锡市玉祁红光电子有限公司以及王福泉提供连带责任保证，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行取得质押借款人民币 500 万元，借款期限自 2013 年 7 月 3 日至 2014 年 1 月 3 日。本公司将 2013 年 7 月 3 日至 2014 年 7 月 3 日发生的所有应收账款进行质押。利息为基准利率上浮 10%。

2、应付票据

种类	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

3、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	45,436,036.02	42,569,425.08
合计	45,436,036.02	42,569,425.08

公司应付账款为应付供应商货款，公司 2013 年末应付账款较 2012 年末有所增加，但是增幅不高，为应付账款的正常波动。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

2013 年 12 月 31 日

供应商名称	金额(元)	占应付账款总额的比	账龄	款项性质
-------	-------	-----------	----	------

		例 (%)		
宁波康强电子股份有限公司	7,990,280.21	17.59	一年以内	货款
宁波华龙电子股份有限公司	6,402,445.61	14.09	一年以内	货款
北京达博有色金属焊料有限责任公司	4,201,956.78	9.25	一年以内	货款
江阴康强电子有限公司	2,769,042.53	6.09	一年以内	货款
江阴新杰科技有限司	2,588,888.46	5.70	一年以内	货款
合 计	24,306,978.97	52.72		

2012年12月31日

供应商名称	金额 (元)	占应付款总额的比例 (%)	账 龄	款项性质
宁波华龙电子有限公司	6,237,684.51	14.65	一年以内	货款
北京达博有色金属焊料有限责任公司	5,161,307.03	12.12	一年以内	货款
宁波康强电子股份有限公司	4,347,663.52	10.21	一年以内	货款
江阴新杰科技有限公司	2,242,246.75	5.27	一年以内	货款
上海铭洋半导体科技有限公司	2,242,145.03	5.27	一年以内	货款
合计	20,231,046.84	47.52		

4、预收款项

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
1 年以内	296,731.94	201,282.67
合计	296,731.94	201,282.67

截至2013年12月31日，公司应付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

截至2013年12月31日，预收账款金额较大的情况如下：

单位名称	金额 (元)	占预收款项总额的比例 (%)	账 龄	款项性质
上海明达微电子有限公司	176,201.78	59.38	1 年以内	预收货款
宁波江东格尉电子科技有限公司	53,028.18	17.87	1 年以内	预收货款
上海超立电子有限公司	27,070.13	9.12	1 年以内	预收货款
广州卓芯电子科技有限公司	15,729.00	5.30	1 年以内	预收货款
上海煜芯太阳能科技有限公司	15,234.81	5.13	1 年以内	预收货款
合计	296,731.94	96.81		

截至2012年12月31日，预收账款金额前五名的情况如下：

单位名称	金额 (元)	占预收款项总额的比例 (%)	账 龄	款项性质
深圳市宏广源科技发展有限公司	114,222.54	56.75	1 年以内	预收货款

宁波江东格尉电子科技有限公司	53,028.18	26.35	1年以内	预收货款
昆山东捷电子材料有限公司	13,359.58	6.64	1年以内	预收货款
北京市锐石电子公司	9,521.39	4.73	1年以内	预收货款
深圳市矽瑞特科技有限公司	5,067.99	2.52	1年以内	预收货款
合计	195,199.68	96.99		

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	21,122,948.71	100.00	23,100,939.55	100.00
合计	21,122,948.71	100.00	23,100,939.55	100.00

截至2013年12月31日，其他应付款中713万元为向自然人借款，借款利率为8%。

(2) 其他应付款按性质列示如下：

性质	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
工程设备采购款	8,987,148.38	42.55	11,141,045.49	48.23
资金拆借款	4,802,268.77	22.73	1,110,000.00	4.81
向个人借款	7,130,000.00	33.75	10,760,000.00	46.58
其中：关联方	6,060,000.00	28.69	3,450,000.00	14.93
其他	203,531.56	0.96	89,894.06	0.39
合计	21,122,948.71	100.00	23,100,939.55	100.00

公司应付非关联方的设备采购款，主要包括公司二期车间机电安装工程、土建工程、装片机、键合机、测试系统、切筋系统等。公司设备采购经采购计划、选定供应商并签订合同、设备安装及调试等多项程序，并根据合同约定逐步付款。

资金拆借款为向关联方的临时借款，未签署协议，未约定利息。

向个人借款签署了借款协议，约定借款利率为8%，借款期限1年，借款到期时可续借，期限顺延。如需要收回本金，应提前一个月通知公司。

截至2013年12月31日，协议借款余额明细如下：

姓名	年末余额(元)	任职单位
魏丽娟	3,000,000.00	红光微
任耀进	1,220,000.00	红光微
陈小芳	1,070,000.00	红光微
任泉明	1,020,000.00	红光微
陶光亮	450,000.00	红光微
陈璐	370,000.00	红光微
合计	7,130,000.00	

截至本公开转让说明书签署时，上述公司向自然人协议借款尚未清偿。

2012年度、2013年度公司为向自然人借款支付的利息分别为838,535.89元，

798,932.60 元。

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五位情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
魏丽娟	7,100,000.00	33.61	1 年以内	关联方借款
无锡北大建筑工程有限公司	3,350,000.00	15.86	1 年以内	货款
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	1,993,536.16	9.44	1 年以内	设备款
任耀进	1,220,000.00	5.78	1 年以内	关联方借款
陈小芳	1,070,000.00	5.07	1 年以内	向个人借款
合计	14,733,536.16	69.75		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款情况如下：

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例（%）	账龄	款项性质
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	7,208,308.12	31.20	1 年以内	设备款
魏丽娟	3,110,000.00	13.46	1 年以内	关联方借款
陈小芳	1,290,000.00	5.58	1 年以内	向个人借款
无锡北大建筑工程有限公司	1,080,000.00	4.68	1 年以内	设备款
邹梅芬	1,000,000.00	4.33	1 年以内	向个人借款
合计	13,688,308.12	59.25		

报告期内，其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见公开转让说明书之“第四节公司财务”之“五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

6、应交税费

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	878,539.05	780,279.95
印花税	3,295.20	3,384.20
企业所得税	-206,883.21	-106,495.51
城市维护建设税	50,106.31	41,268.83
房产税	20,684.70	20,684.70
土地使用税	25,465.80	25,465.80
教育税附加	35,790.22	29,477.73
防洪资金	29,663.82	34,450.65
合计	836,661.89	828,516.35

7、长期应付款

(1) 长期应付款分类列示

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付上海恒信金融租赁有限公司	7,912,499.96	6,566,069.66

减：未确认的融资费用	1,061,648.99	127,506.93
减：一年内到期部分	3,532,491.42	4,468,520.66
合计	3,318,359.55	1,970,042.07

(2) 长期应付款合同明细

合同编号	融资租赁合总价款	物件购买总价	实际每期租金	租赁期	本期长期应付款	未确认融资费用
L11A0186001	2,233,018.24	1,914,337.62	154,179.23	2011/5/24 - 2014/5/24	153,916.00	4,536.91
L11A0186002	4,589,294.04	3,934,522.80	316,865.79	2011/6/7 - 2014/6/7	316,325.00	9,321.40
L11A0186003	2,671,505.40	2,299,167.00	184,306.00	2012/1/10 - 2015/1/9	735,796.00	51,393.89
L11A0186004	3,236,902.12	2,785,870.62	223,310.67	2012/1/10 - 2015/1/9	891,512.00	62,254.72
L13A0746001	4,799,097.11	3,975,588.00	110,433.00	2013/10/11 - 2016/9/11	3,644,289.00	579,788.69
L13A0746002	2,774,424.74	2,298,348.00	63,843.00	2013/11/6 - 2016/10/6	2,170,661.96	354,353.38
合计	—	—	—	—	7,912,499.96	1,061,648.99

8、一年内到期的非流动负债

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
一年内到期的长期应付款	3,532,491.42	4,468,520.66
合计	3,532,491.42	4,468,520.66

(七) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013年12月31日余额	2012年12月31日余额
股本	32,180,000.00	22,180,000.00
资本公积	5,835,530.14	-23,632.00
盈余公积		3,511,200.08
未分配利润	2,544,794.50	14,636,123.41
少数股东权益	-	-
股东权益合计	40,560,324.64	40,303,691.49

1、股本及资本公积变动情况说明：

截至 2013 年 9 月 9 日止，红光微之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的原有限公司 2013 年 5 月 31 日经审计净资产人民币 38,044,953.14 元为基准折股，其中人民币 3,218 万元折合为红光微的股本，股份总额为 3,218 万股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 3,218 万元整，余额人民币 5,864,953.14 元作为资本公积。

2、盈余公积变动情况说明：

2012 年、2013 年，公司分别提取盈余公积 374,500.72 元、189,868.34 元。2013 年 9 月，公司股份制改造时，将盈余公积 3,706,148.30 元作为净资产的一部分转入股本和资本公积。2013 年 12 月 31 日，盈余公积余额为零。

五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
王福泉	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
魏丽娟	实际控制人、公司持股 5%以上的股东、董事、王福泉配偶

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与本公司关系
玉祁红光	受实际控制人王福泉控制的公司
蓝箭电子	受实际控制人魏丽娟所控股的公司
任耀进	公司股东、董事
任泉明	财务总监
蔡振华	董事、副总经理
陶光亮	董事、副总经理
陈璐	监事
唐良	监事
许小弟	职工监事

玉祁红光和蓝箭电子基本情况见下表：

序号	公司名称	持股比例	经营范围
1	玉祁红光	王福泉直接持有其 100.00% 股权	电子元器件、变压器、电讯电器、电源整机的制造及加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的，经批准后方可经

			营)。
2	蓝箭电子	魏丽娟持有其 100.00%股权	电子器材、PVC 塑料管的制造、加工。

(二) 关联方交易

1、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年		2012 年	
			金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)
玉祁红光	加工产品	公允定价	2,943,253.84	2.78	-	-
蓝箭电子	采购商品	公允定价	312,228.00	0.29	164,851.90	0.15
合计			3,255,481.84	3.07	164,851.90	0.15

报告期内，公司主要委托玉祁红光对产品进行划片加工，玉祁红光与公司结算的价格与行业非关联公司报价一致，价格公允。公司向关联方蓝箭电子采购包装物-塑料管，其采购单价与全年该货物的平均采购价格皆为 0.43 元，其采购价格公允。

2、出售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013 年		2012 年	
			金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)
玉祁红光	出售商品	公允定价	318,095.50	0.25	212,134.87	0.16
合计			318,095.50	0.25	212,134.87	0.16

报告期内，公司向关联方玉祁红光出售的商品为公司封装的相关产品，价格与非关联方定价一致。玉祁红光与红光微属于相同行业，但是设备不一样，能够封装的芯片也不一样。报告期内，存在玉祁红光接到封装业务后，由公司封装并销售给玉祁红光，玉祁红光再向外出售的情况。公司已经于 2014 年停止了向玉祁红光出售商品。公司向玉祁红光的销售占比非常低，对公司利润影响非常小。

(三) 关联方往来

1、其他应收款

关联方	性质	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		账面余额 (元)	占其他应收款总额的比重 (%)	账面余额	占其他应收款总额的比重 (%)
王福泉	无息拆借款	75,739.91	3.49	50,639.91	1.19

玉祁红光	无息拆借款			2,521,889.57	59.11
合计		75,739.91	3.49	2,572,529.48	60.30

其他应收款应收王福泉款项为备用金，玉祁红光为关联方资金拆借，未签订协议及约定利息。截至2013年12月31日，玉祁红光拆借款已经归还公司。

2、应付账款

关联方	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额(元)	占应付账款总额的比重(%)	账面余额(元)	占应付账款总额的比重(%)
蓝箭电子	261,243.90	0.57	162,400.51	0.38
合计	261,243.90	0.57	162,400.51	0.38

3、其他应付款

关联方	性质	2013年12月31日		2012年12月31日	
		账面余额(元)	占其他应付款总额的比重(%)	账面余额(元)	占其他应付款总额的比重(%)
魏丽娟	个人借款	3,000,000.00	14.20	2,000,000.00	8.66
	无息拆借款	4,100,000.00	19.41	1,110,000.00	4.80
任耀进	个人借款	1,220,000.00	5.78	870,000.00	3.77
任泉明	个人借款	1,020,000.00	4.83	150,000.00	0.65
陈璐	个人借款	370,000.00	1.75	210,000.00	0.91
陶光亮	个人借款	450,000.00	2.13	220,000.00	0.95
玉祁红光	无息拆借款	702,268.77	3.32		
合计		10,862,268.77	51.42	4,560,000.00	19.74

公司2013年末应付关联方大额借款余额中，应付魏丽娟410万元及应付玉祁红光70.22万元为关联方资金拆借，未签署借款协议，未约定利息，未规定偿还期限。应付魏丽娟、任泉明等5位关联自然人的借款合计606万元签署了借款协议，约定借款利率为8%，借款期限1年，借款到期时可续借，期限顺延。如需要收回本金，应提前一个月通知公司。2014年4月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会和第一届监事会第二次会议上，对上述关联方借款分别予以认可，认为该关联交易未对公司、股东及债权人的利益造成重大不利影响。

(四) 关联方资金拆借

(1) 2012年关联方资金拆借

关联方	年初数	本年增加	本年减少	年末数	性质
拆入：					
任耀进	870,000.00			870,000.00	个人借款
任泉明	150,000.00			150,000.00	个人借

					款
陈璐	210,000.00			210,000.00	个人借款
陶光亮	100,000.00	120,000.00		220,000.00	个人借款
魏丽娟	2,000,000.00			2,000,000.00	个人借款
	1,500,000.00	4,618,111.60	5,008,111.60	1,110,000.00	无息拆借款
玉祁红光	3,693,031.30	3,950,000.00	10,164,920.87	-2,521,889.57	无息拆借款
小 计	8,523,031.30	8,688,111.60	15,173,032.47	2,038,110.43	
拆出:					
王福泉	1,060,589.82	2,590,050.09	3,600,000.00	50,639.91	无息拆借款
小 计	1,060,589.82	2,590,050.09	3,600,000.00	50,639.91	

(2) 2013 关联方年资金拆借

关联方	年初数	本年增加	本年减少	年末数	说明
拆入:					
任耀进	870,000.00	350,000.00		1,220,000.00	个人借款
任泉明	150,000.00	970,000.00	100,000.00	1,020,000.00	个人借款
陈璐	210,000.00	220,000.00	60,000.00	370,000.00	个人借款
陶光亮	220,000.00	230,000.00		450,000.00	个人借款
魏丽娟	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00	个人借款
	1,110,000.00	6,500,000.00	3,510,000.00	4,100,000.00	无息拆借款
小 计	4,560,000.00	9,270,000.00	3,670,000.00	10,160,000.00	
拆出:					
玉祁红光	2,521,889.57	13,374,537.54	15,194,158.34	702,268.77	无息拆借款
王福泉	50,639.91	2,275,100.00	2,250,000.00	75,739.91	无息拆借款
小 计	2,572,529.48	15,649,637.54	17,444,158.34	778,008.68	

公司报告期内存在与关联方的资金拆借情况，部分为个人借款，已经支付了相关利息；部分为无息拆借款。根据公司 2012 年、2013 年的实际拆借情况，按照同期公司向魏丽娟、任泉明等关联自然人的实际借款利率 8.0%进行测算，假定公司借出资金需要收取相应的利息，公司借入资金需要支付相应的利息，利息收入与利息支出相抵后，公司两

年共需额外支付利息 22.56 万元。

(五) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡市玉祁红光电子有限公司提供反担保	无锡市科发投资担保有限公司	5,000,000.00	2013年9月11日	2016年3月8日	否
无锡市玉祁红光电子有限公司提供反担保	无锡市新区创友融资担保有限公司	5,000,000.00	2013年3月6日	2016年3月16日	否
王福泉、无锡市玉祁红光电子有限公司	无锡红光微电子股份有限公司	5,000,000.00	2013年7月3日	2016年7月2日	否
王福泉、魏丽娟、任耀进	红光微	7,912,500.00	2010年11月10日	2018年10月6日	否
无锡红光微电子股份有限公司、王福泉	玉祁红光	5,000,000.00	2012年7月5日	2016年7月4日	否
无锡红光微电子股份有限公司、王福泉、魏丽娟	玉祁红光	5,000,000.00	2013年5月27日	2017年5月26日	否

(六) 报告期内关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段公司未制定专门的关联交易决策制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定。因此在有限公司阶段发生的较重大的关联方交易，均未履行董事会或股东会决议程序；公司发生的关联方资金往来，未履行董事会或股东(大)会决议程序，实践中主要是根据公司制定的财务管理制度，由公司总经理签字确认。

股份公司设立后，公司制定了《关联交易决策制度》，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

2014年4月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于近两年关联交易的议案》，对瑞华审字[2014]31120006号《审计报告》披露的公司近二年与关联方发生的关联交易予以认可，认为相关关联交易未对公司、股东及债权人的利益造成重大不利影响。

2014年4月10日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于近两年关联交易的议案》，对瑞华审字[2014]31120006号《审计报告》披露的公司近二年与关联方

发生的关联交易予以认可，认为相关关联交易未对公司、股东及债权人的利益造成重大不利影响。

（七）减少及规范关联交易的具体措施

公司报告期内发生的关联方交易类型包括关联方采购、关联方销售和关联方资金拆借。

公司的关联方采购和关联方销售金额、比例均很低，对公司不构成重大影响。未来公司会按照关联交易决策程序，减少并规范必要的关联方采购和关联方销售。

公司的关联方资金拆借金额较高，且公司对关联方资金有一定依赖。该情况的发生背景为报告期内，公司新建了二期厂房，资金较为紧张。2014年5月，公司二期厂房已经建造、装修完毕，并投入使用。公司的固定资产投资规模将大幅下降。随着二期厂房的投入使用，公司的产能与订单也在增加，预期未来经营活动产生的现金流量将足够覆盖投资活动需要的现金流量。公司将逐步归还向关联方的拆借款。

2014年4月7日，公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

“本人作为无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股东、董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易做出如下承诺：

本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的对公司财务状况及经营成果有重大影响的或有事项。

截至本说明书签署之日，公司无需要披露的对公司财务状况及经营成果有重大影响。

公司需要披露的其他重要事项主要为未来需支付的租赁费用：

（1）各类租入固定资产的各期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
-----	-------------	-------------

一、账面原值	14,073,010.38	14,073,010.38
合计	14,073,010.38	14,073,010.38
二、累计折旧	7,695,292.83	5,150,780.67
合计	7,695,292.83	5,150,780.67
三、账面净值	6,377,717.55	8,922,229.71
合计	6,377,717.55	8,922,229.71
四、减值准备		
合计		
五、账面价值	6,377,717.55	8,922,229.71
合计	6,377,717.55	8,922,229.71

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	4,188,861.00
1年以上2年以内(含2年)	2,091,312.00
2年以上3年以内(含3年)	1,632,327.00
3年以上	-
合计	7,912,500.00

(3) 截止2013年12月31日,未确认融资费用余额为1,061,648.99元,分摊未确认融资费用所采用的方法为实际利率法。

七、报告期内公司资产评估情况

中同华资产评估有限公司接受委托,采用资产基础法,以2013年5月31日为评估基准日对公司净资产的市场价值进行评估,并于2013年9月6日出具《无锡红光微电子股份有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告书》(中同华评报字[2013]第338号),具体结果如下:

“本次评估采用资产基础法对无锡红光微电子公司净资产价值进行评估。无锡红光¹公司经审计后资产账面价值为14,206.95万元,负债为10,402.46万元,净资产为3,804.49万元。

采用资产基础法确定的无锡红光红丝净资产评估价值为6,124.50万元,比审计后账面净资产增值2,320.01万元,增值率为60.98%。增值原因为:

1、流动资产增值164.77万元,系存货评估增值164.77万元。增值原因系存货中的产成品、发出商品等账面值仅反映其制造成本,评估值中除包含完全成本外还含有已创造的适当利润,故有所增值。

¹评估公司简称公司为无锡红光

2、固定资产评估增值 485.30 万元。无锡红光公司的固定资产增值主要系设备类资产增值，增值的原因为：企业的折旧年限短于设备的经济使用年限，其账面净值已不能反映其真实的现行价值，故造成本次资产评估的增值。

3、无形资产——土地使用权评估增值 1,662.41 万元，随着国家土地政策的调控，土地资源的稀缺，导致土地市场价格的上涨，从而致使评估增值。”

八、最近两年股利分配政策和分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年分配情况

- 1、公司最近两年按规定提取法定公积金；
- 2、公司 2013 年 9 月 9 日由有限公司整体变更为股份公司时，全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的原有限公司 2013 年 5 月 31 日经审计净资产人民币 38,044,953.14 元为基准折股，其中人民币 3,218 万元折合为无锡红光微电子股份有限公司的股本，股份总额为 3,218 万股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 3,218 万元整，余额人民币 5,864,953.14 元作为资本公积。
- 3、2013 年发放现金红利 970,259.80 元。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司报告期内尚未制定相关政策。公司计划在进入全国股份转让系统挂牌工作完成后完成相关制度制定。在未制定新政策之前，暂按原股利分配政策执行。

九、管理层对公司风险因素自我评估

（一）实际控制人不当控制的风险

王福泉、魏丽娟夫妇合计直接持有公司 99.00%的股权，对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，王福泉、魏丽娟夫妇均为公司董事，且王福泉为公司董事长、

总经理，可对公司施加重大影响。若王福泉、魏丽娟夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（二）公司内部控制的的风险

有限公司阶段及股份公司成立初期，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东（大）会审议的情形。

2013年9月9日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《货币资金管理办法》等内部制度等规章制度；2013年9月9日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；2014年4月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司采取的风险管理措施如下：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策

制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（三）受半导体行业景气状况影响的风险

公司主要业务是半导体器件的封装与测试，位于芯片设计与应用的中间环节，与芯片设计及应用环节紧密相连。如果下游半导体器件应用行业或上游芯片设计行业受半导体行业景气状况出现较大波动，将势必对半导体器件封装与测试行业带来较大影响，公司发展也将会受到一定的影响。

针对上述风险，公司采取的风险管理措施如下：

在提高产品质量的基础上，加强市场开拓，逐步实现客户种类的多样化，减少单一行业客户景气状况波动给公司业务带来的不利影响。

（四）生产要素价格上涨所致的盈利能力下滑风险

半导体器件封装与测试行业属于典型的加工制造业，以及劳动密集型产业。原材料、生产设备、劳动力价格上涨均会对公司的盈利能力带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的风险管理措施如下：

努力提高公司产品的技术含量和市场竞争力，增加公司产品的技术附加值，减少公司利润对原材料、设备、产业工人工资等成本控制的依赖性。

（五）公司大规模固定资产投资导致的资产负债率较高的风险

公司报告期内投资新建了二期厂房以进一步扩大生产。同时，公司的设备也在稳定的更新中。预计公司在未来一年仍然有大规模的固定资产投资活动。由于公司采取债权融资的方式进行大量固定资产投资，包括新建厂房和购买设备，导致公司负债率较高，公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日资产负债率分别为 70.81%、72.27%。总体来说，公司资产期限与负债期限不配比，有一定的偿债风险。

针对上述风险，公司采取的风险管理措施如下：

加快新厂房、生产设备投产，产生经营性现金流，同时做好应收账款回收工作，减少因资产负债率过高所致的偿债风险。

（六）公司对非经常性损益存在较大引起的利润波动风险

公司 2012 年度、2013 年度净利润分别为 249.67 万元、126.58 万元，扣非后的净利润分别为 161.22 万元、-9.66 万元，非经常性损益占同期净利润的比例分别为 107.63%、35.43%，公司对非经常性损益存在较大依赖。如公司未来非经常性利润不能持续，将对公司利润情况产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的风险管理措施如下：

公司将加大研发，提高产品技术含量和毛利率，增强公司主营业务盈利能力，减少对政府补贴等非经常性损益的依赖。

（七）担保风险

玉祁红光向中国银行股份有限公司无锡惠山支行、中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行分别贷款 500 万元，公司作为保证人分别向该两家银行为玉祁红光提供最高额为 500 万元的还款担保，担保到期日分别为 2016 年 7 月 4 日、2017 年 5 月 26 日。玉祁红光为公司控股股东王福泉控制的其它企业。

玉祁红光向中国银行股份有限公司惠山支行的 500 元贷款中，除红光微担保外，玉祁红光以自有土地使用权及地上厂房向中国银行股份有限公司惠山支行提供最高额为 600 万元的抵押担保，该土地及房产评估价值总计为 977.88 万元。

上述担保的债务中，虽然有一项债务有玉祁红光土地及厂房同时作抵押担保。但如果债务偿还期限届满时，玉祁红光发生财务危机不能还款，公司将应当按照担保合同承担保证责任，公司生产经营将遭受一定的不利影响。

针对上述风险，公司采取的风险管理措施如下：

上述担保责任期限届满后，公司将不再为玉祁红光提供贷款担保。

（八）流动性不足、负债率过高风险

2012 年年底、2013 年年底，公司资产负债率均在 70%以上，且流动比率低于 1，截止 2013 年 12 月 31 日，短期借款余额 2800 万元。此外，公司还为控股股东控制的玉祁红光借款共计 1000 万元提供担保，虽然其中的 500 万元有玉祁红光土地及厂房同时作抵押担保，但仍有 500 万元未有其他形式担保，或反担保。公司存在负债率过高所致的偿债风险、流动性不足风险。

针对上述风险，公司采取的风险管理措施如下：

公司将加强应收账款管理，及时回收资金，减少债务融资额度，逐步开展股权融资，降低公司负债率。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事：(签字)

王福泉： 王福泉

魏丽娟： 魏丽娟

任耀进： 任耀进

陶光亮： 陶光亮

蔡振华： 蔡振华

公司全体监事：(签字)

陈璐： 陈璐

唐良： 唐良

许小弟： 许小弟

公司全体高级管理人员：(签字)

王福泉： 王福泉

任泉明： 任泉明

任耀进： 任耀进

陶光亮： 陶光亮

无锡红光微电子股份有限公司

2014年 7月 29日



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

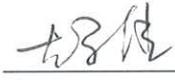
项目小组成员：（签字）



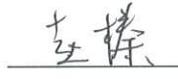
杨慧佳



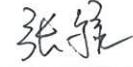
林义明



尤家佳



赵 霖



张 騷

项目负责人：（签字）



杨慧佳

法定代表人或授权代表：（签字）



申银万国证券股份有限公司

2014年 7月29日

三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：（签字）



王恩顺



王越



邓炜

律师事务所负责人：（签字）



邹志强



（签章）

北京大成（上海）律师事务所

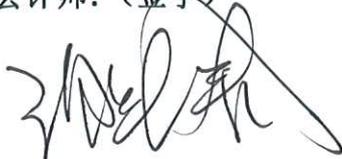
2014年 7月 29日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：（签字）

涂新春



赵现波



会计师事务所负责人：（签字）

顾仁荣



（签章）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年7月29日



五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：（签字）

徐建福



张麟



资产评估机构负责人：（签字）

季珉



（签章）

北京中同华资产评估有限公司

2014年 7月 29日



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及证监会核准文件